Z590 AORUS ULTRA

사용자 설명서

개정판 1002

12MK-Z59UTRA-1002R

자세한 제품 정보는 GIGABYTE 웹사이트를 참조하십시오.

지구 온난화 방지를 위하여 본 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 포장재를 사용하였습니다. GIGABYTE는 소비자와 함께 환경을 보호합니다.

저작권

면책조항

이 설명서에 포함된 정보는 저작권법 보호를 받으며 GIGABYTE의 재산입니다. 이 설명서에 포함된 명세와 특징은 GIGABYTE에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다. GIGABYTE의 사전 서면 허가 없이는 이 문서의 일부 또는 전부를 어떤 형식이나 방법으로도 복제, 복사, 번역, 전송 또는 출판할 수 없습니다.

문서 분류

이 제품의 사용을 돕기 위해 GIGABYTE는 다음 종류의 문서를 제공합니다.

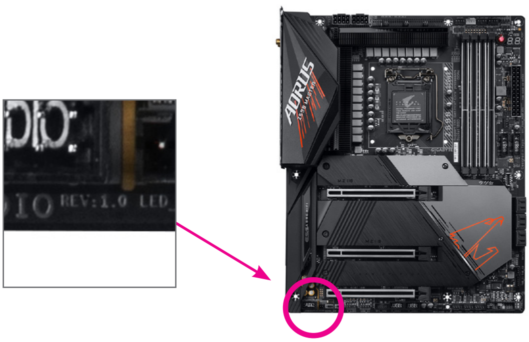
- 빠른 제품 설치에 대해서는 제품과 함께 제공된 빠른 설치 가이드를 읽으십시오.
- 자세한 제품 정보에 대해서는 사용자 설명서를 숙독하십시오.

제품 관련 정보는 당사 웹 사이트에서 확인하십시오. https://www.gigabyte.com/kr

메인보드 수정 버전 식별

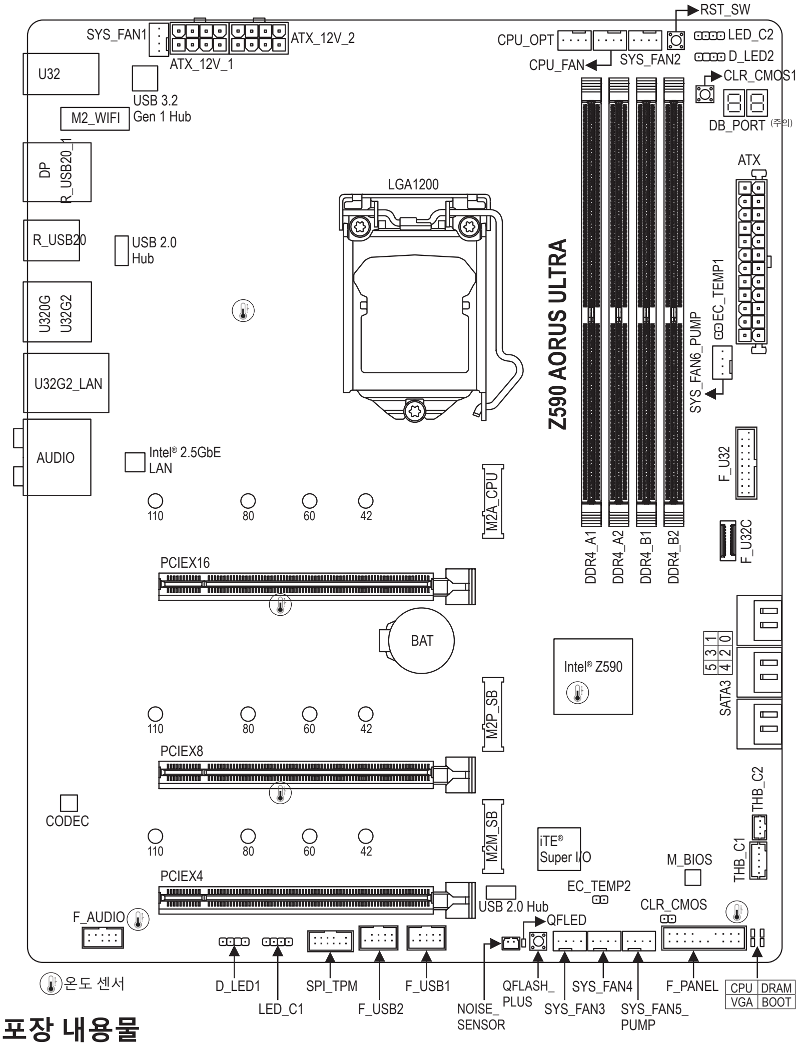
메인보드에 있는 수정 버전 번호는 "REV: X.X." 예를 들어, "REV: 1.0"은 메인보드의 수정 버전이 1.0이라는 의미입니다. 메인보드 BIOS나 드라이버를 업데이트하거나 기술 정보를 찾을 때는 메인보드 수정 버전을 먼저 확인하십시오.

예:



목 차

Z590 AORUS ULTRA 메인보드 레이아웃



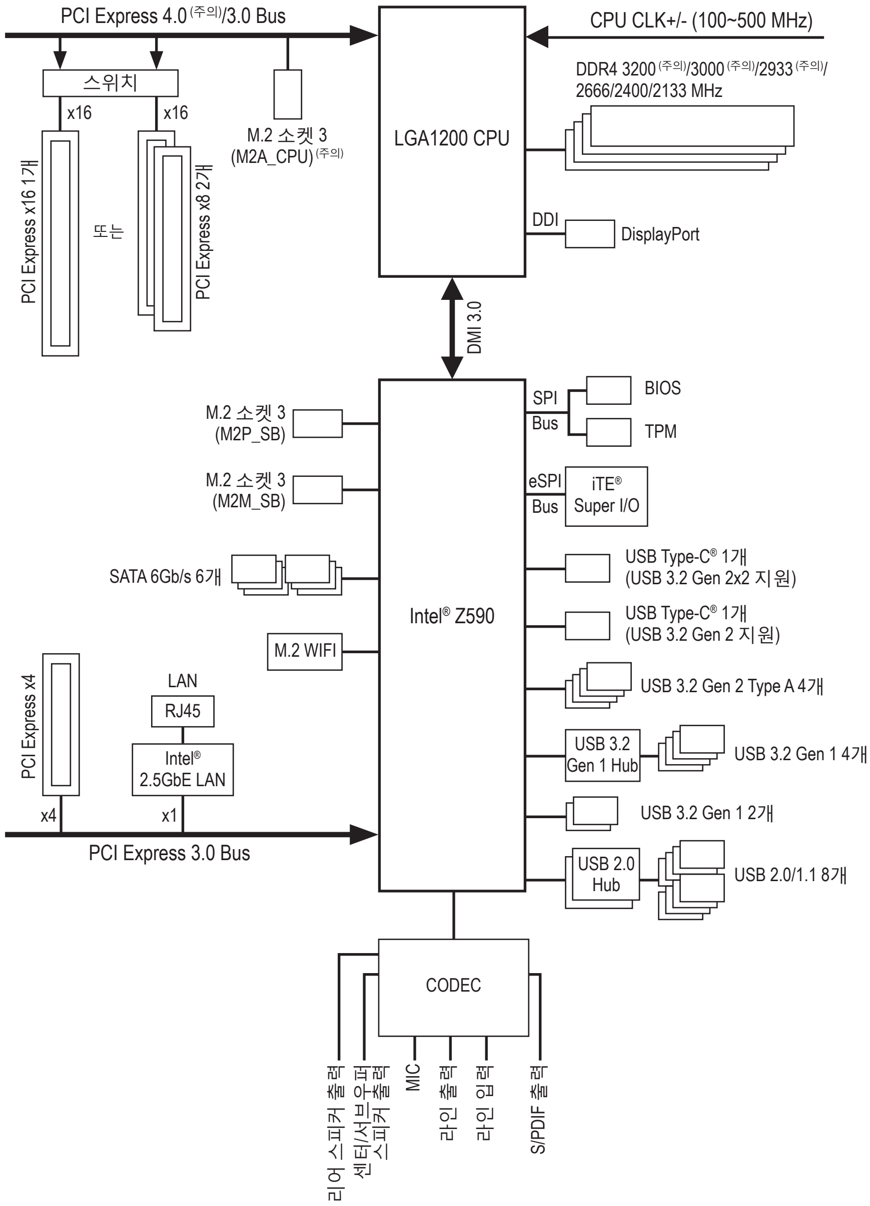
포장 내용물

- ☑ Z590 AORUS ULTRA 메인보드
- ☑ 사용자 설명서
- ☑ 빠른 설치 가이드
- ☑ RGB LED 스트립 연장 케이블 1개
- ☑ SATA 케이블 4개
- ☑ 안테나 1개
- ☑ M.2 나사
- ☑ G 커넥터 1개
- ☑ 소음 감지 케이블 1개
- ☑ 서미스터 케이블 2개

* 위의 포장 내용물을 참조용일 뿐이며 실제 판매되는 품목은 각자 구매한 제품 패키지에 따라 다릅니다. 제품 내용물은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

(주의) 디버그 코드 정보는 제3장을 참조하십시오.

Z590 AORUS ULTRA 메인보드 블록 다이어그램



(주의) 실제 지원은 CPU에 따라 다를 수 있습니다.

제1장 하드웨어 설치

1-1 설치 주의사항

메인보드는 ESD(정전방전)으로 인해 손상될 수 있는 민감한 전자회로와 부품을 많이 포함하고 있기 때문에 설치 전에 사용자 설명서를 숙독 후 다음 절차를 따르십시오. 설치하기 전에 사용 설명서를 주의해서 읽고 다음 절차를 따르십시오:

- 설치하기 전에 PC 케이스(샤시)가 메인보드에 적합한지 확인하십시오.
- 설치 전에 판매점에서 제공한 메인보드 S/N(일련번호) 스티커나 보증 스티커를 제거하거나 뜯지 마십시오. 스티커는 보증 확인에 필요합니다.
- 메인보드나 기타 하드웨어 부품을 설치하거나 제거하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑아 AC 전원을 분리하십시오.
- 하드웨어 부품을 메인보드의 내부 커넥터에 연결할 때, 이들이 제대로 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드 취급 시, 금속 리드나 커넥터를 만지지 마십시오.
- 메인보드, CPU 또는 메모리와 같은 전자 부품을 취급할 때는 정전기 방전(ESD) 손목 띠를 착용하는 것이 좋습니다. 정전기 방지 손목 띠가 없으면 마른 손으로 금속 물체를 먼저 만져 정전기를 제거하십시오.
- 메인보드를 설치하기 전에, 정전기 방지 패드 위 또는 정전기 차폐 용기 안에 놓으십시오.
- 메인보드에서 전원 공급장치 케이블의 플러그를 꽂거나 뽑기 전에 전원 공급장치의 전원이 꺼졌는지 확인하십시오.
- 전원을 끄기 전에, 전원 공급장치 전압이 지역의 전압 규격에 맞게 설정되었는지 확인하십시오.
- 제품을 사용하기 전에, 하드웨어 부품의 모든 케이블 및 전원 커넥터가 연결되었는지 확인하십시오.
- 메인보드의 손상을 방지하기 위해, 나사가 메인보드 회로나 부품에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 메인보드 위에, 또는 컴퓨터 케이스 안에 나사나 금속 부품이 남아 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 시스템을 평평한 바닥에 두십시오.
- 고온이나 습기가 있는 환경에 컴퓨터를 설치하지 마십시오.
- 설치 과정 중에 컴퓨터 전원을 켜면 시스템 부품이 손상될 수 있을 뿐만 아니라 사용자 신체적 상해를 입을 수 있습니다.
- 설치 방법에 대해 잘 모르거나 제품 사용과 관련해서 문제가 생기면 공인 컴퓨터 기술자에게 문의하십시오.
- 어댑터, 전원 연장 케이블 또는 멀티 탭을 사용하는 경우, 설치 및 또는 접지 설명서를 참조하십시오.

1-2 제품 사양

CPU	◆	LGA1200 패키지: - 11세대 Intel® Core™ i9 프로세서/Intel® Core™ i7 프로세서/Intel® Core™ i5 프로세서 - 10세대 Intel® Core™ i9 프로세서/Intel® Core™ i7 프로세서/Intel® Core™ i5 프로세서/Intel® Core™ i3 프로세서/Intel® Pentium® 프로세서/Intel® Celeron® 프로세서* * 4 MB Intel® Smart Cache, Intel® Celeron® G5xx5 제품군을 탑재한 프로세서에 국한됨. (최신 CPU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 참고하십시오.)
	◆	L3 캐시는 CPU에 따라 다름
칩셋	◆	Intel® Z590 Express 칩셋
메모리	◆	11세대 Intel® Core™ i9/i7/i5 프로세서: - DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz 메모리 모듈 지원
	◆	10세대 Intel® Core™ i9/i7 프로세서 - DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz 메모리 모듈 지원
	◆	10세대 Intel® Core™ i5/i3/Pentium®/Celeron® 프로세서: - DDR4 2666/2400/2133 MHz 메모리 모듈 지원
	◆	최대 128GB (32GB 단일 DIMM 용량)의 시스템 메모리를 지원하는 DDR4 DIMM 소켓 4개
	◆	듀얼 채널 메모리 아키텍처
	◆	ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 메모리 모듈 지원 (비-ECC 모드에서 작동)
	◆	비-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 메모리 모듈 지원
	◆	XMP(Extreme Memory Profile) 메모리 모듈 지원 (최신 지원되는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
온보드 그래픽	◆	통합 그래픽 프로세서 - Intel® HD 그래픽 지원: - 4096x2304@60 Hz의 최대 해상도를 지원하는 DisplayPort 1개 * DisplayPort 1.2 버전 및 HDCP 2.3 지원. (그래픽 사양은 CPU 지원에 따라 다를 수 있습니다.)
오디오	◆	Realtek® ALC4080 코덱
	◆	DTS:X® Ultra 지원
	◆	HD 오디오
	◆	2/4/5.1/7.1채널
	◆	S/PDIF 입출력 지원
LAN	◆	Intel® 2.5GbE LAN 칩(2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)
무선 통신 모듈	◆	Intel® Wi-Fi 6 AX200 - 2.4/5GHz 듀얼 밴드를 지원하는 WIFI a, b, g, n, ac, ax - BLUETOOTH 5.1 - 11ax 160MHz 무선 표준 및 최대 2.4 Gbps 데이터 속도 지원 * 실제 데이터 속도는 환경과 장비에 따라 달라질 수 있습니다.

확장 슬롯	◆ PCI Express x16 슬롯 1개, x16 모드에서 실행(PCIEX16) * 최적의 성능을 확보하려면 PCI Express 그래픽 카드를 하나만 설치하는 경우 이를 반드시 PCIEX16 슬롯에 설치하십시오. ◆ PCI Express x16 슬롯 1개, x8 모드에서 실행(PCIEX8) * PCIEX8 슬롯은 PCIEX16 슬롯과 대역폭을 공유합니다. PCIEX8 슬롯을 장착하면 PCIEX16 슬롯이 최대 x8 모드에서 동작합니다. (PCIEX16 및 PCIEX8 슬롯은 PCI Express 4.0 표준을 따릅니다.) (주의) ◆ PCI Express x16 슬롯 1개, x4 모드에서 실행(PCIEX4) (PCIEX4 슬롯은 PCI Express 3.0 표준을 따릅니다.)
멀티그래픽 기술	◆ AMD Quad-GPU CrossFire™ 및 2-웨이 AMD CrossFire™ 기술 지원
저장 장치 인터페이스	◆ CPU: - M.2 커넥터 1개(소켓 3, M 키, 유형 2242/2260/2280/22110 PCIe 4.0 x4/x2 SSD 지원) (M2A_CPU) (주의) ◆ 칩셋: - M.2 커넥터 1개(소켓 3, M 키, type 2242/2260/2280/22110 SATA 및 PCIe 3.0 x4/x2 SSD 지원) (M2P_SB) - M.2 커넥터 1개(소켓 3, M 키, 유형 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4/x2 SSD 지원) (M2M_SB) - SATA 6Gb/s 커넥터 6개 ◆ RAID 0, RAID 1, RAID 5 및 RAID 10 지원 * M.2 및 SATA 커넥터의 설치 공지는 "1-9 내부 커넥터"를 참조하십시오. ◆ Intel® Optane™ Memory Ready
USB	◆ 칩셋: - 뒷면 패널에 USB Type-C® 포트 1개(USB 3.2 Gen 2x2 지원) - USB 3.2 Gen 2를 지원하는 USB Type-C® 포트 1개, 내부 USB 헤더를 통해서 사용할 수 있음 - 뒷면 패널에 USB 3.2 Gen 2 Type-A 포트(빨간색) 4개 - 내부 USB 헤더를 통해 사용 가능한 USB 3.2 Gen 1 포트 2개 ◆ 칩셋+USB 3.2 Gen 1 Hub: - 뒷면 패널에 USB 3.2 Gen 1 포트 4개 ◆ 칩셋+USB 2.0 Hub 2개: - USB 2.0/1.1 포트 8개 (뒷면 패널에 4개 포트, 내부 USB 헤더를 통한 4개 포트 사용 가능)
내부 커넥터	◆ 24핀 ATX 주 전원 커넥터 1개 ◆ 8핀 ATX 12V 전원 커넥터 2개 ◆ CPU 팬 헤더 1개 ◆ 수냉식 CPU 팬 헤더 1개 ◆ 시스템 팬 헤더 4개 ◆ 시스템 팬/수냉식 펌프 헤더 2개 ◆ 주소 지정이 가능한 LED 스트립 헤더 2개 ◆ RGB LED 스트립 헤더 2개 ◆ M.2 Socket 3 커넥터 3개 ◆ SATA 6Gb/s 커넥터 6개

(주의) 11세대 프로세서에서만 지원됨.

내부 커넥터	◆ 전면 패널 헤더 1개 ◆ 전면 패널 오디오 헤더 1개 ◆ USB Type-C® 헤더 1개(USB 3.2 Gen 2 지원) ◆ USB 3.2 Gen 1 헤더 1개 ◆ USB 2.0/1.1 헤더 2개 ◆ Thunderbolt™ 애드인 카드 커넥터 2개 ◆ 소음 감지 헤더 1개 ◆ 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 헤더 1개(GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 모듈 전용) ◆ 리셋 버튼 1개 ◆ CMOS 클리어 버튼 1개 ◆ Q-Flash Plus 버튼 1개 ◆ CMOS 클리어 점퍼 1개 ◆ 온도 센서 헤더 2개
뒷면 패널 커넥터	◆ DisplayPort 1개 ◆ SMA 안테나 커넥터(2T2R) 2개 ◆ USB Type-C® 포트 1개(USB 3.2 Gen 2x2 지원) ◆ USB 3.2 Gen 2 Type-A 포트(빨간색) 4개 ◆ USB 3.2 Gen 1 포트 4개 ◆ USB 2.0/1.1 포트 4개 ◆ RJ-45 포트 1개 ◆ 광 S/PDIF 출력 커넥터 1개 ◆ 오디오 잭 5개
입출력 컨트롤러	◆ iTE® I/O 컨트롤러 칩
하드웨어 모니터	◆ 전압 감지 ◆ 온도 감지 ◆ 팬 속도 감지 ◆ 수냉식 유량 감지 ◆ 팬 고장 경고 ◆ 팬 속도 제어 * 팬(펌프) 속도 제어 기능의 지원 여부는 설치한 팬(펌프)의 종류에 좌우됩니다. ◆ 소음 감지
BIOS	◆ 256 Mbit 플래시 1개 ◆ 라이선스 AMI UEFI BIOS 사용 ◆ PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

고유 기능	◆	APP Center 지원 * APP Center에서 사용 가능한 애플리케이션은 메인보드 모델에 따라 다를 수 있습니다. 각 애플리케이션의 지원되는 기능도 메인보드 사양에 따라 다를 수 있습니다. - @BIOS - EasyTune - Fast Boot - Game Boost - ON/OFF Charge - RGB Fusion - Smart Backup - System Information Viewer
	◆	Q-Flash Plus 지원
	◆	Q-Flash 지원
	◆	Xpress Install 지원
번들 소프트웨어	◆	Norton® Internet Security(OEM 버전)
	◆	cFosSpeed
운영 체제	◆	Windows 10 64비트 지원
폼 팩터	◆	ATX 폼팩터, 30.5cm x 24.4cm

* GIGABYTE에는 사전 고지 없이 어떤 식으로든 제품 사양 및 제품 관련 정보를 변경할 권한이 있습니다.

CPU, 메모리 모듈, SSD 및 M.2 장치의 지원 목록은 GIGABYTE 의 웹사이트를 참조하십시오.

최신 버전의 앱은 GIGABYTE 웹사이트의 **Support\Utility List** 페이지에서 다운로드하십시오.

1-3 CPU 설치

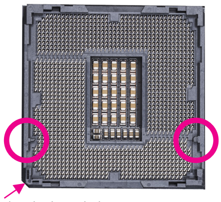
CPU를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 CPU를 지원하는지 확인하십시오.
  (최신 CPU 지원 목록에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 참고하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 CPU를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- CPU 중 1개의 핀을 찾으십시오. CPU는 잘못된 방향으로 되어 있으면 삽입할 수 없습니다. (또는 CPU 양쪽에 있는 노치와 CPU 소켓에 있는 맞춤 키를 찾으십시오.)
- CPU 표면에 고르고 얇은 층으로 서멀 그리스를 바르십시오.
- CPU 쿨러가 설치되어 있지 않으면 컴퓨터를 켜지 마십시오. 그렇지 않으면 CPU 과열과 손상이 일어날 수 있습니다.
- CPU 규격에 따라 CPU 호스트 주파수를 설정하십시오. 시스템 버스 주파수가 하드웨어 규격을 초과하도록 설정하는 것은 주변 장치의 표준 요구 사항을 만족하지 않으므로 좋지 않습니다. 주파수가 표준 규격을 초과하도록 설정하려면 CPU, 그래픽 카드, 메모리, 하드 드라이브 등의 하드웨어 규격에 따라 설정하십시오.

CPU 설치

메인보드 CPU 소켓에 있는 정렬 키와 CPU의 노치 위치를 확인하십시오.

LGA1200 CPU 소켓



LGA1200 CPU

CPU를 삽입하기 전에 CPU 소켓 커버를 제거하지 마십시오. CPU를 삽입한 후 레버를 다시 장착하는 동안 로드 플레이트에서 자동으로 튀어 나올 수 있습니다.

1-4 메모리 설치

메모리를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:

- 메인보드가 해당 메모리를 지원하는지 확인하십시오. 같은 용량, 상표, 속도 및 칩의 메모리를 사용하는 것이 좋습니다.
  (최신 지원되는 메모리 속도 및 메모리 모듈에 대해서는 GIGABYTE 웹 사이트를 방문하십시오.)
- 하드웨어 손상을 방지하려면 메모리를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 메모리 모듈은 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 메모리 모듈은 한 방향으로만 설치할 수 있습니다. 메모리를 삽입할 수 없는 경우 방향을 바꾸어 보십시오.

듀얼 채널 메모리 구성

이 메인보드는 4개의 메모리 소켓을 제공하고 듀얼 채널 기술을 지원합니다. 메모리가 설치된 후 BIOS가 메모리의 규격과 용량을 자동으로 감지합니다. 듀얼 채널 메모리 모듈을 사용하도록 설정하면 원래 메모리 대역폭이 두 배로 늘어납니다.

하드웨어 설치에 대한 자세한 내용은 GIGABYTE의 웹사이트를 참조하십시오.

4개의 메모리 소켓은 두 채널로 나뉘고 각 채널에는 다음 2개 메모리 소켓이 있습니다.
- 채널 A: DDR4_A1, DDR4_A2
- 채널 B: DDR4_B1, DDR4_B2

- 권장 듀얼 채널 메모리 구성:

	DDR4_A1	DDR4_A2	DDR4_B1	DDR4_B2
2개 모듈	- -	DS/SS	- -	DS/SS
4개 모듈	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=단면, DS=양면, "- -"=메모리 없음)

CPU 제한이 있으므로 메모리를 듀얼 채널 모드로 설치하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.

1. 메모리 모듈이 하나만 설치되어 있을 경우 듀얼 채널 모드를 사용할 수 없습니다.
2. 메모리 모듈이 2개 또는 네 개인 듀얼 채널 모드를 활성화할 경우, 용량, 브랜드, 속도, 칩이 동일한 메모리를 사용할 것을 권장합니다.

1-5 확장 카드 설치

확장 카드를 설치하기 전에 다음 지침을 따르십시오:
- 메인보드가 해당 확장카드를 지원하는지 확인하십시오. 확장 카드에 함께 포함된 설명서를 숙독하십시오.
- 하드웨어 손상을 방지하려면 확장 카드를 설치하기 전에 반드시 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

1-6 AMD CrossFire™ 구성 설정하기

A. 시스템 요구사항

- Windows 10 64-비트 운영 체제
- PCI Express x16 슬롯이 두 개인 CrossFire 지원 메인보드 및 올바른 드라이버
- 브랜드와 칩이 동일한 CrossFire 사용 그래픽 카드 및 올바른 드라이버
- CrossFire(주의) 브리지 커넥터
- 전력량이 충분한 전원 공급장치를 권장합니다. (전원 요구 사항은 그래픽 카드의 설명서를 참조하십시오.)

B. 그래픽 카드 연결하기

1단계:
그래픽 카드를 PCIEX16 및 PCIEX8 슬롯에 설치합니다.
2단계:
CrossFire(주의) 브리지 커넥터를 카드 상단의 CrossFire 금박 가장자리 커넥터에 끼웁니다.
3단계:
디스플레이 케이블을 PCIEX16 슬롯에 삽입한 그래픽 카드에 연결합니다.

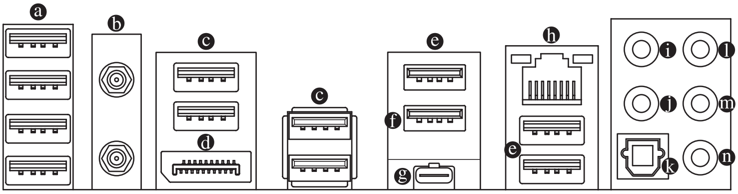
C. 그래픽 카드 드라이버 구성하기

운영 체제에 그래픽 카드 드라이버를 설치한 다음, **AMD RADEON SETTINGS** 화면으로 이동합니다. **Gaming\Global Settings**로 이동하여 **AMD CrossFire**가 **On**으로 설정되어 있는지 확인합니다.

(주의) 그래픽 카드 종류에 따라 브리지 커넥터의 필요 여부가 달라집니다.

CrossFire 기술을 활성화하기 위한 절차나 드라이버 화면은 그래픽 카드 및 드라이버 버전에 따라 다를 수 있습니다. CrossFire 활성화에 관한 자세한 내용은 그래픽 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

1-7 뒷면 패널 커넥터



ⓐ USB 3.2 Gen 1 포트

USB 3.2 Gen 1 포트는 USB 3.2 Gen 1 사양을 지원하며 USB 2.0 사양과 호환됩니다. 이 포트는 USB 장치용으로 사용합니다.

ⓑ SMA 안테나 커넥터(2T2R)

이 커넥터를 사용하여 안테나를 연결합니다.

신호를 더 잘 수신하기 위해 안테나를 안테나 커넥터에 조인 후 안테나 방향을 올바르게 조정하십시오.

ⓒ USB 2.0/1.1 포트

USB 포트는 USB 2.0/1.1 규격을 지원합니다. 이 포트는 USB 장치용으로 사용합니다.

ⓓ DisplayPort

DisplayPort는 고품질 디지털 이미징과 오디오를 제공하고 양방향 오디오 전송을 지원하는 신세대 인터페이스 기술 중 하나입니다. DisplayPort는 HDCP 2.3 컨텐츠 보호 메커니즘을 지원할 수 있습니다. 이 포트를 DisplayPort-지원 모니터 연결용으로 사용할 수 있습니다. 주의: DisplayPort 기술은 해상도를 최대 4096x2304@60 Hz까지 지원할 수 있지만 실제 지원되는 해상도는 사용 중인 모니터에 따라 달라집니다.

DisplayPort 장치를 설치한 다음, 기본 사운드 재생 장치가 DisplayPort로 설정되었는지 확인하십시오. (항목 이름은 사용자의 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.)

ⓔ USB 3.2 Gen 2 Type-A 포트(빨간색)

USB 3.2 Gen 2 포트는 USB 3.2 Gen 2 사양을 지원하며 USB 3.2 Gen 1 및 USB 2.0 사양과 호환됩니다. 이 포트는 USB 장치용으로 사용합니다.

ⓕ USB 3.2 Gen 2 Type-A 포트(빨간색) (Q-Flash Plus 포트)

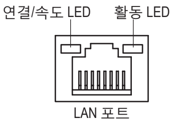
USB 3.2 Gen 2 포트는 USB 3.2 Gen 2 사양을 지원하며 USB 3.2 Gen 1 및 USB 2.0 사양과 호환됩니다. Q-Flash Plus (주의)를 사용하기 전에 우선 이 포트에 USB 플래시 드라이브를 삽입해야 합니다.

ⓖ USB Type-C® 포트

무방향성 USB 포트가 USB 3.2 Gen 2x2 사양을 지원하며 USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 및 USB 2.0 사양과 호환됩니다. 이 포트는 USB 장치용으로 사용합니다.

ⓗ RJ-45 LAN 포트

Gigabit 이더넷 LAN 포트는 최대 2.5 Gbps 데이터 속도의 인터넷 연결을 제공합니다. 다음은 LAN 포트 LED 상태에 대한 설명입니다.



연결/속도 LED:

상태	설명
녹색	2.5 Gbps 데이터 속도
주황색	1 Gbps 데이터 속도
끄기	100 Mbps 데이터 속도

활동 LED:

상태	설명
깜빡임	데이터 전송 또는 수신 중
켜짐	데이터 전송 또는 수신 없음

(주의) Q-Flash Plus 기능을 활성화하려면 GIGABYTE 웹사이트의 "고유한 특장점" 웹 페이지를 참조하십시오.

ⓘ **센터/서브우퍼 스피커 출력**
이 오디오 잭을 사용하여 센터/서브우퍼 스피커를 연결하십시오.

ⓙ **리어 스피커 출력**
이 오디오 잭을 사용하여 후면 스피커를 연결하십시오.

ⓚ **광 S/PDIF 출력 커넥터**
이 커넥터는 디지털 광 오디오를 지원하는 외부 오디오 시스템에 디지털 오디오 출력을 제공합니다. 이 기능을 사용하기 전에 오디오 시스템이 광 디지털 오디오 입력 커넥터를 제공하는지 확인하십시오.

ⓛ **라인 입력/측면 스피커 출력**
라인 입력 잭입니다. 광 드라이브, Walkman과 같은 장치에 이 오디오 잭을 사용하십시오.

ⓜ **라인 출력/전면 스피커 출력**
라인 출력 잭입니다. 이 잭은 오디오 증폭 기능을 지원합니다. 음질을 개선하려면 헤드폰/스피커를 이 잭에 연결할 것을 권장합니다(실제 효과는 사용 중인 장치에 따라 다를 수 있습니다).

ⓝ **마이크 입력**
마이크 입력 잭입니다.

오디오 잭 구성 :

잭	헤드폰/ 2채널	4채널	5.1채널	7.1채널
ⓘ 센터 / 서브우퍼 스피커 출력			✔	✔
ⓙ 리어 스피커 출력		✔	✔	✔
ⓛ 라인 입력 / 측면 스피커 출력				✔
ⓜ 라인 출력 / 전면 스피커 출력	✔	✔	✔	✔
ⓝ 마이크 입력				✔

- 측면 스피커를 설치하려면, 오디오 드라이버를 통한 측면 스피커 출력을 위해 라인 입력 잭 작업을 해야 합니다.
- 라인 출력의 오디오 증폭 기능을 활성화하거나 구성하려면 Realtek Audio Console 애플리케이션에 액세스하십시오.

오디오 소프트웨어 구성에 대한 자세한 내용은 GIGABYTE의 웹사이트를 참조하십시오.

- 후면 패널 커넥터에 연결된 케이블을 제거할 때는 장치에서 케이블을 먼저 제거한 후 메인보드에서 제거하십시오.
- 케이블을 제거할 때는 커넥터에서 케이블을 똑바로 뽑으십시오. 케이블 커넥터 안의 전기 단락을 방지하려면 좌우로 흔들지 마십시오.

1-8 온보드 버튼 및 LED

퀵버튼

이 메인보드에는 2개의 퀵버튼이 있습니다.즉 리셋 버튼 및 클리어 CMOS 버튼입니다. 하드웨어 부품 교체 또는 테스트로 인해 컴퓨터 케이스가 열린 상태에서 리셋 버튼을 사용하여 빨리 전원을 끄고 켤 수 있습니다. 필요에 따라 이 버튼을 사용하여 BIOS 구성을 삭제하고 CMOS 값을 공장 기본값으로 초기화 할 수 있습니다.

RST_SW: Reset(리셋) 버튼

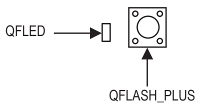
초기화 버튼으로 몇 가지 기능을 사용할 수 있습니다. 버튼을 다시 매핑하여 다른 작업을 수행하려면 2장 "BIOS 설정"의 "Settings\Miscellaneous\RST_SW"에서 자세한 내용을 참조하십시오.

CLR_CMOS1: CMOS 버튼 지우기

- CMOS 값을 지우기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 주의: 시스템이 켜져 있을 때 CMOS 소거 버튼을 누르지 마십시오. 그럴 경우 시스템이 종료되어서 데이터를 잃거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 시스템이 다시 시작되면 BIOS Setup으로 이동하여 공장 기본값을 로드하거나(Load Optimized Defaults 선택) BIOS 설정을 수동으로 구성하십시오(BIOS 구성에 대해서는 제2장, "BIOS 설치,"을 참조).

Q-Flash Plus 버튼

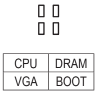
시스템이 꺼져 있을 때(S5가 꺼진 상태) Q-Flash Plus를 이용해서 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. 최신 BIOS를 USB 썸드라이브에 저장하고 전용 포트에 연결한 다음 Q-Flash Plus 버튼을 누르기만 하면 BIOS를 자동으로 플래시할 수 있습니다. BIOS 일치 및 플래싱 작업이 시작되면 QFLED가 깜박이고, 메인 BIOS 플래싱이 완료되면 깜박임이 중지됩니다.



Q-Flash Plus 기능을 사용하는 방법은 GIGABYTE 웹사이트의 "고유한 특장점" 웹 페이지를 참조하십시오.

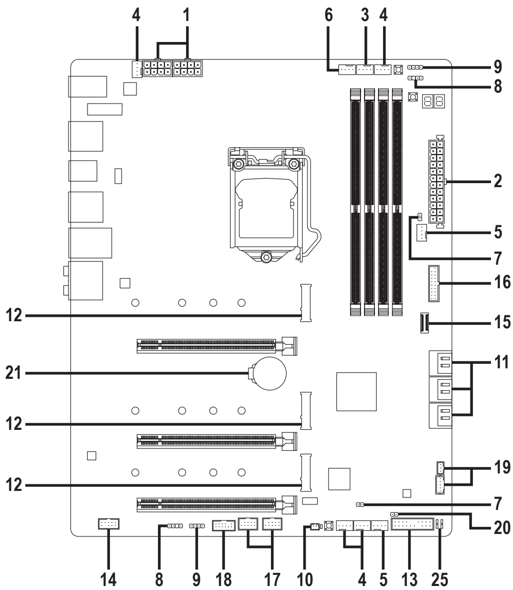
상태 LED

상태 LED는 시스템 전원을 켠 후 CPU, 메모리, 그래픽 카드 및 운영 체제가 올바르게 작동하는지 여부를 표시합니다. CPU/DRAM/VGA LED가 켜져 있으면 해당 장치가 정상적으로 작동하지 않는다는 의미이고, BOOT LED가 켜져 있으면 운영 체제로 아직 진입하지 못했음을 나타냅니다.



CPU: CPU 상태 LED
DRAM: 메모리 상태 LED
VGA: 그래픽 카드 상태 LED
BOOT: 운영 체제 상태 LED

1-9 내부 커넥터



1)	ATX_12V_1/ATX_12V_2	12)	M2A_CPU/M2P_SB/M2M_SB
2)	ATX	13)	F_PANEL
3)	CPU_FAN	14)	F_AUDIO
4)	SYS_FAN1/2/3/4	15)	F_U32C
5)	SYS_FAN5_PUMP/SYS_FAN6_PUMP	16)	F_U32
6)	CPU_OPT	17)	F_USB1/F_USB2
7)	EC_TEMP1/EC_TEMP2	18)	SPI_TPM
8)	D_LED1/D_LED2	19)	THB_C1/THB_C2
9)	LED_C1/LED_C2	20)	CLR_CMOS
10)	NOISE_SENSOR	21)	BAT
11)	SATA3 0/1/2/3/4/5		

외부 장치를 연결하기 전에 다음 지침을 읽으십시오.

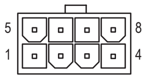
- 먼저 장치가 연결하고자 하는 커넥터와 호환되는지 확인하십시오.
- 장치를 설치하기 전에 장치와 컴퓨터를 끄십시오. 장치 손상을 방지하려면 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 장치를 설치한 후 컴퓨터를 켜기 전 장치 케이블이 메인보드의 커넥터에 단단히 연결되었는지 확인하십시오.

1/2) ATX_12V_1/ATX_12V_2/ATX (2x4 12V 전원 커넥터 및 2x12 주 전원 커넥터)

전원 커넥터의 사용으로 전원 공급 장치는 메인보드의 모든 부품에 충분히 안정적인 전력을 공급할 수 있습니다. 전원 커넥터를 연결하기 전에 먼저 전원 공급 장치가 꺼져 있고 모든 장치가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 전원 커넥터는 실수를 방지하도록 설계되어 있습니다. 전원 공급 케이블을 전원 커넥터에 올바른 방향으로 연결하십시오.

12V 전원 커넥터는 주로 CPU에 전력을 공급합니다. 12V 전원 커넥터가 연결되어 있지 않으면 컴퓨터를 시작할 수 없습니다.

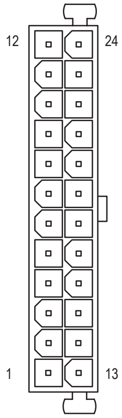
확장 요구 사항을 만족하려면 높은 소비 전력(500W 이상)을 견딜 수 있는 전원 공급 장치를 권합니다. 필요 전력을 공급하지 못하는 전원 공급 장치가 사용된 경우 시스템이 불안정하거나 부팅되지 않을 수 있습니다.



ATX_12V_1/
ATX_12V_2

ATX_12V_1/ATX_12V_2:

핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	GND (2x4 핀 12V 전용)	5	+12V(2x4 핀 12V 전용)
2	GND (2x4 핀 12V 전용)	6	+12V(2x4 핀 12V 전용)
3	GND	7	+12V
4	GND	8	+12V



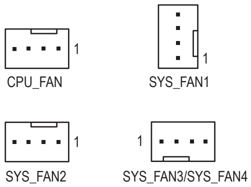
ATX

ATX:

핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON(소프트 켜기/끄기)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	전원 양호	20	NC
9	5VSB (대기 +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V(2x12 핀 ATX에만 해당)	23	+5V(2x12 핀 ATX에만 해당)
12	3.3V(2x12 핀 ATX에만 해당)	24	GND(2x12 핀 ATX 전용)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN1/2/3/4(팬 헤더)

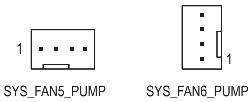
이 메인보드에 있는 모든 팬 헤더는 4-핀입니다. 대부분의 팬 헤더는 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오 (흑색 커넥터 전선은 접지선입니다). 속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다. 최적의 방열을 위해서는 시스템 팬을 PC 케이스(샤시) 안에 설치하는 것이 좋습니다.



핀 번호	정의
1	GND
2	전압 속도 제어
3	감지
4	PWM 속도 제어

5) SYS_FAN5_PUMP/SYS_FAN6_PUMP(시스템 팬/수냉식 펌프 헤더)

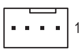
팬/펌프 헤더는 4핀식입니다. 대부분의 팬 헤더는 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오(흑색 커넥터 전선은 접지선입니다). 속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다. 최적의 방열을 위해서는 시스템 팬을 PC 케이스(샤시) 안에 설치하는 것이 좋습니다. 헤더는 수냉식 펌프에 속도 제어 기능도 제공합니다. 자세한 내용은 2장 "BIOS 설치", "Smart Fan 6"를 참조하십시오.



핀 번호	정의
1	GND
2	전압 속도 제어
3	감지
4	PWM 속도 제어

6) CPU_OPT(수냉식 CPU 팬 헤더)

팬 헤더는 4핀으로서 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 대부분의 팬 헤더는 실수로 삽입하는 것을 방지하도록 설계되어 있습니다. 팬 케이블을 연결할 때는 꼭 올바른 방향으로 연결하십시오(흑색 커넥터 전선은 접지선입니다). 속도 조절 기능을 하려면 팬 속도 조절이 되는 팬을 사용해야 합니다.



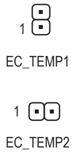
핀 번호	정의
1	GND
2	전압 속도 제어
3	감지
4	PWM 속도 제어

커넥터	CPU_FAN	SYS_FAN1~4	SYS_FAN5/6_PUMP	CPU_OPT
최대 전류	2A	2A	2A	2A
최대 전력	24W	24W	24W	24W

- CPU 및 시스템의 과열을 막으려면 꼭 팬 헤더에 팬 케이블을 연결하십시오. 과열은 CPU에 손상을 일으키거나 시스템 장애를 일으킬 수 있습니다.
- 이 팬 헤더는 구성 점퍼 블록이 아닙니다. 헤더에 점퍼 캡을 씌우지 마십시오.

7) EC_TEMP1/EC_TEMP2(온도 센서 헤더)

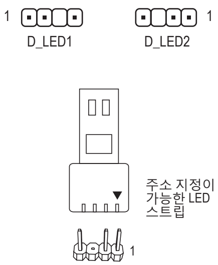
서미스터 케이블을 헤더에 연결하여 온도를 감지합니다.



핀 번호	정의
1	센서 입력
2	GND

8) D_LED1/D_LED2(주소 지정이 가능한 LED 스트립 헤더)

헤더는 5A(5V)의 최대 정격 전력과 최대 1000개의 LED로 주소 지정이 가능한 표준 5050 LED 스트립에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

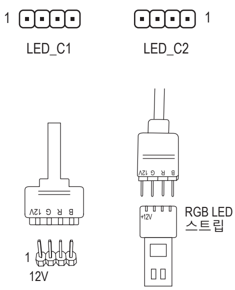


핀 번호	정의
1	V (5V)
2	데이터
3	핀 없음
4	GND

주소 지정이 가능한 LED 스트립을 헤더에 연결합니다. LED 스트립의 전원 핀(플러그에 삼각형이 표시되어 있음)을 주소 지정이 가능한 LED 스트립 헤더의 핀 1에 연결해야 합니다. 잘못 연결하면 LED 스트립이 손상될 수 있습니다.

9) LED_C1/LED_C2 (RGB LED 스트립 헤더)

이 헤더를 표준형 5050 RGB LED 스트립(12V/G/R/B)을 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 정격 전원은 2A(12V)이며 최대 길이는 2m입니다.



핀 번호	정의
1	12V
2	G
3	R
4	B

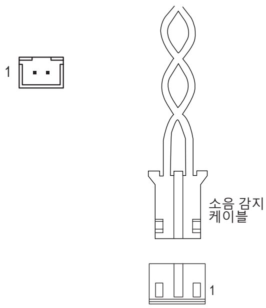
RGB LED 연장 케이블의 한쪽 끝을 헤더에 연결하고 다른 한쪽 끝은 RGB LED 스트립에 연결합니다. 연장 케이블의 검은색 와이어(플러그에 삼각형이 표시되어 있음)가 이 헤더의 핀 1(12V)에 연결되어야 합니다. 연장 케이블의 반대쪽 끝에 있는 12V 핀(화살표로 표시)이 LED 스트립의 12V와 정렬되어야 합니다. LED 스트립의 연결 방향에 특히 주의하십시오. 잘못 연결하면 LED 스트립이 손상될 수 있습니다.

LED 스트립의 라이트를 켜거나 끄는 방법은 GIGABYTE 웹사이트의 "Unique Features (고유 기능)"를 참조하십시오.

장치를 설치하기 전에 장치와 컴퓨터를 끄십시오. 장치 손상을 방지하려면 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

10) NOISE_SENSOR (소음 감지 헤더)

이 헤더는 소음 감지 케이블을 연결해서 케이스 내부 소음을 감지하는 데 사용됩니다.



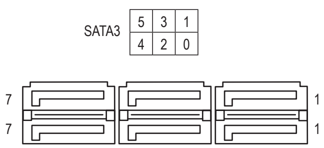
핀 번호	정의
1	소음 감지
2	GND

소음 감지 기능에 대한 자세한 내용은 GIGABYTE 웹사이트의 "고유한 특장점" 웹 페이지를 참조하십시오.

케이블을 헤더에 연결하기 전에 점퍼 캡을 벗겨야 합니다. 헤더를 사용하지 않을 때는 점퍼 캡을 도로 씌우십시오.

11) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/s 커넥터)

SATA 커넥터는 SATA 6Gb/s 표준을 준수하며 SATA 3Gb/s 및 SATA 1.5Gb/s 표준과 호환됩니다. 각 SATA 커넥터는 단일 SATA 장치를 지원합니다. Intel® 칩셋은 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10를 지원합니다. RAID 배열 구성에 대한 지침은 제3장, "RAID 세트 구성하기"를 참조하십시오.

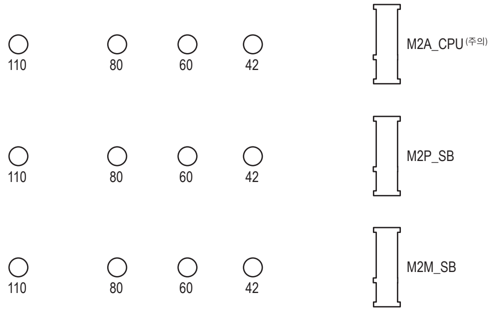


핀 번호	정의
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

SATA 포트에서 핫 플러그를 사용하기 위한 자세한 내용은 제2장 "BIOS 설치", "Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration"을 참조하십시오.

12) M2A_CPU (주의)/M2P_SB/M2M_SB (M.2 Socket 3 커넥터)

M.2 커넥터는 M.2 SATA SSD 또는 M.2 PCIe SSD를 지원하고 RAID 구성을 지원합니다. M.2 PCIe SSD는 M.2 SATA SSD 또는 SATA 하드 드라이브 중 어느 쪽과도 RAID 세트를 만드는 데 사용할 수 없습니다. RAID 배열 구성에 대한 지침은 제3장, "RAID 세트 구성하기"를 참조하십시오.



아래의 단계에 따라 M.2 커넥터에 M.2 SSD를 올바로 설치하십시오.

1단계:

M.2 SSD를 설치할 곳에서 M.2 위치를 찾아 스크루드라이버를 사용하여 방열판의 나사를 푼 후 방열판을 제거합니다. M.2 커넥터의 열전도 패드에서 보호 필름을 벗겨내십시오.

2단계:

M.2 SSD 드라이브의 길이에 따라 올바른 장착 구멍을 찾으십시오. 필요한 경우 스탠드오프를 원하는 장착 구멍으로 이동하십시오. M.2 SSD를 비스듬히 M.2 커넥터에 끼웁니다.

3단계:

M.2 SSD를 아래로 누른 후 제공된 나사를 사용하여 이를 커넥터에 고정합니다. 방열판을 도로 제자리에 위치시킨 후 원래의 구멍에 고정합니다. 방열판을 교체하기 전에 방열판 밑면에서 보호 필름을 벗겨내십시오.

(주의) 11세대 프로세서에서만 지원됨. M2A_CPU 커넥터에서 RAID 구성을 설정하려면 Intel® SSD를 사용하십시오.

M.2 및 SATA 커넥터용 설치 공지:

SATA 커넥터의 가용성은 M.2 소켓에 설치되어 있는 장치 유형의 영향을 받을 수도 있습니다. M2P_SB 커넥터는 SATA3 1 커넥터와 대역폭을 공유합니다.

- M2A_CPU (주의):

커넥터 / M.2 SSD의 유형	SATA3 0	SATA3 1	SATA3 2	SATA3 3	SATA3 4	SATA3 5
M.2 PCIe SSD *	✔	✔	✔	✔	✔	✔
설치된 M.2 SSD 없음	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✔: 이용 가능, ✕: 이용할 수 없음

* M2A_CPU 커넥터는 PCIe SSD만 지원합니다.

- M2P_SB:

커넥터 / M.2 SSD의 유형	SATA3 0	SATA3 1	SATA3 2	SATA3 3	SATA3 4	SATA3 5
M.2 SATA SSD	✔	✕	✔	✔	✔	✔
M.2 PCIe SSD	✔	✔	✔	✔	✔	✔
설치된 M.2 SSD 없음	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✔: 이용 가능, ✕: 이용할 수 없음

- M2M_SB:

커넥터 / M.2 SSD의 유형	SATA3 0	SATA3 1	SATA3 2	SATA3 3	SATA3 4	SATA3 5
M.2 PCIe SSD *	✔	✔	✔	✔	✔	✔
설치된 M.2 SSD 없음	✔	✔	✔	✔	✔	✔

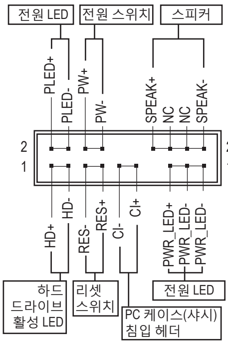
✔: 이용 가능, ✕: 이용할 수 없음

* M2M_SB 커넥터는 PCIe SSD만 지원합니다.

(주의) 11세대 프로세서에서만 지원됨.

13) F_PANEL(앞면 패널 헤더)

아래의 핀 지정에 따라 PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 스위치, 리셋 스위치, 스피커, PC 케이스(샤시) 침입 스위치/센서 및 시스템 상태 표시기를 이 헤더에 연결하십시오. 케이블을 연결하기 전에 양극과 음극 핀에 주목하십시오.



- **PLED/PWR_LED** (전원 LED):

시스템 상태	LED
S0	켜짐
S3/S4/S5	끄기

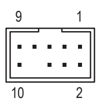
PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 상태 표시기에 연결됩니다. 시스템이 작동 중이면 LED가 켜집니다. 시스템이 S3/S4 절전 상태에 있거나 전원이 꺼지면(S5) LED가 꺼집니다.

- **PW** (전원 스위치):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 전원 스위치에 연결됩니다. 전원 스위치를 사용하여 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다(자세한 내용은 제2장 "BIOS 설치", "Settings\Platform Power" 참조).
- **SPEAK** (스피커):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 스피커에 연결됩니다. 시스템이 신호음을 통해 시스템 시작 상태를 알립니다. 시스템을 시작할 때 문제가 감지되지 않으면 한 번의 짧은 신호음이 납니다.
- **HD** (하드 드라이브 활동 LED):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 하드 드라이브 활동 LED에 연결됩니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓸 때 LED가 켜집니다.
- **RES** (초기화 스위치):
  PC 케이스(샤시) 전면 패널의 리셋 스위치에 연결됩니다. 컴퓨터가 작동을 멈추어 정상적으로 다시 시작할 수 없는 경우 리셋 스위치를 누르십시오.
- **CI** (PC 케이스(샤시) 침입 헤더):
  PC 케이스(샤시) 커버가 제거될 경우 이를 감지할 수 있는 PC 케이스(샤시) 침입 스위치/센서를 PC 케이스(샤시)에 연결합니다. 이 기능을 사용하려면 PC 케이스(샤시) 침입 스위치/센서가 있는 PC 케이스(샤시)가 필요합니다.
- **NC:** 연결 없음.

전면 패널 설계는 PC 케이스(샤시)에 따라 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 활동 LED, 스피커 등으로 구성됩니다. PC 케이스(샤시) 전면 패널 모듈을 헤더에 연결할 때는 전선 지정과 핀 지정이 정확히 일치하는지 확인하십시오.

14) F_AUDIO(앞면 패널 오디오 헤더)

전면 패널 오디오 헤더는 고음질 오디오(HD)를 지원합니다. PC 케이스(샤시) 전면 패널 오디오 모듈을 이 헤더에 연결할 수 있습니다. 모듈 커넥터의 전선 지정이 메인보드 헤더의 핀 지정과 일치하는지 확인하십시오. 모듈 커넥터와 메인보드 헤더를 잘못 연결하면 장치가 작동하지 않거나 손상될 수도 있습니다.

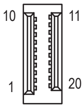


핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	MIC2_L	6	감지
2	GND	7	FAUDIO_JD
3	MIC2_R	8	핀 없음
4	NC	9	LINE2_L
5	LINE2_R	10	감지

일부 PC 케이스(샤시)는 각 전선에 단일 플러그 대신 분리된 커넥터가 있는 전면 패널 오디오 모듈을 제공합니다. 전선 지정이 다른 전면 패널 오디오 모듈을 연결하는 것에 대한 정보는 PC 케이스(샤시) 제조업체에 문의하십시오.

15) F_U32C (USB 3.2 Gen 2를 지원하는 USB Type-C® 헤더)

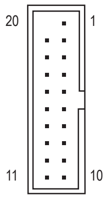
이 헤더는 USB 3.2 Gen 2 규격을 충족하며 한 개의 USB 포트를 제공합니다.



핀 번호	정의	핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	VBUS	8	CC1	15	RX2+
2	TX1+	9	SBU1	16	RX2-
3	TX1-	10	SBU2	17	GND
4	GND	11	VBUS	18	D-
5	RX1+	12	TX2+	19	D+
6	RX1-	13	TX2-	20	CC2
7	VBUS	14	GND		

16) F_U32 (USB 3.2 Gen 1 헤더)

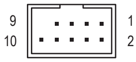
이 헤더는 USB 3.2 Gen 1 및 USB 2.0 사양에 호환되며 2개의 USB 포트를 제공할 수 있습니다. 옵션 사양으로 2개의 USB 3.2 Gen 1 포트를 제공하는 3.5인치 앞면 패널을 구매하려면 가까운 대리점에 문의하시기 바랍니다.



핀 번호	정의	핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	VBUS	8	D1-	15	SSTX2-
2	SSRX1-	9	D1+	16	GND
3	SSRX1+	10	NC	17	SSRX2+
4	GND	11	D2+	18	SSRX2-
5	SSTX1-	12	D2-	19	VBUS
6	SSTX1+	13	GND	20	핀 없음
7	GND	14	SSTX2+		

17) F_USB1/F_USB2(USB 2.0/1.1 헤더)

이 헤더는 USB 2.0/1.1 규격을 준수합니다. 각 USB 헤더는 선택 품목인 USB 브래킷을 통해 USB 포트 2개를 제공합니다. 선택 품목인 USB 브래킷 구매에 대해서는 지역 판매점에 문의하십시오.

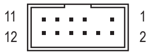


핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	전원(5V)	6	USB DY+
2	전원(5V)	7	GND
3	USB DX-	8	GND
4	USB DY-	9	핀 없음
5	USB DX+	10	NC

- IEEE 1394 브래킷(2x5핀) 케이블을 USB 2.0/1.1 헤더에 연결하지 마십시오.
- USB 브래킷 손상을 방지하려면 USB 브래킷을 설치하기 전에 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.

18) SPI_TPM(보안 플랫폼 모듈 헤더)

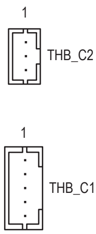
SPI TPM(트러스티드 플랫폼 모듈)을 이 헤더에 연결할 수 있습니다.



핀 번호	정의	핀 번호	정의
1	데이터 출력	7	칩 선택
2	전원(3.3V)	8	GND
3	핀 없음	9	IRQ
4	NC	10	NC
5	데이터 입력	11	NC
6	CLK	12	RST

19) THB_C1/THB_C2 (Thunderbolt™ 애드인 카드 커넥터)

커넥터는 GIGABYTE Thunderbolt™ 애드 인 카드에 연결하는 데 사용됩니다.



THUNDERBOLT™ ready

Thunderbolt™ 애드인 카드를 지원합니다.

20) CLR_CMOS(클리어 CMOS 점퍼)

이 점퍼를 이용해서 BIOS 구성 내용을 삭제하고 CMOS 값을 공장 기본값으로 초기화합니다. CMOS 값을 지우려면 스크류 드라이버 같은 금속으로 2개의 핀을 몇 초간 누르십시오.

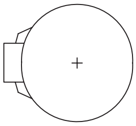
열림: 일반

단락: CMOS 값 소거

- CMOS 값을 지우기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 시스템이 다시 시작되면 BIOS Setup으로 이동하여 공장 기본값을 로드하거나(Load Optimized Defaults 선택) BIOS 설정을 수동으로 구성하십시오(BIOS 구성에 대해서는 제2장, "BIOS 설치,"을 참조).

21) BAT(배터리)

배터리는 컴퓨터가 꺼졌을 때 CMOS에 값(BIOS 구성, 날짜 및 시간 정보 등)을 보존하도록 전원을 제공합니다. 배터리 전압이 낮은 수준으로 떨어지면 배터리를 교체하십시오. 그렇지 않으면 CMOS 값이 정확하지 않거나 손실될 수 있습니다.



배터리를 제거하여 CMOS 값을 지울 수 있습니다.

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑습니다.
2. 배터리 홀더에서 배터리를 꺼낸 후 1분 동안 기다립니다. (또는 드라이버와 같은 금속 물체로 배터리 홀더의 양극과 음극 단자를 5초 동안 접촉하여 단락시키십시오.)
3. 배터리를 교체합니다.
4. 전원 코드를 연결하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.

- 배터리를 교체하기 전에 항상 컴퓨터를 끄고 전원 코드 플러그를 뽑으십시오.
- 배터리를 동등한 것으로 교체하십시오. 배터리를 다른 종류로 교체하면 장치가 손상될 수 있습니다.
- 배터리를 직접 교체할 수 없거나 배터리 모델에 대해 잘 모르면 구매처나 지역 판매점에 문의하십시오.
- 배터리를 설치할 때 배터리의 양극(+)과 음극(-) 방향에 주의하십시오 (양극 쪽이 위를 향해야 합니다).
- 소모된 배터리는 지역 환경 규정에 따라 처리해야 합니다.

제2장 BIOS 설치

BIOS(기본 입출력 시스템)는 시스템의 하드웨어 매개 변수를 메인보드의 CMOS에 기록합니다. 주요 기능에는 시스템 시작, 시스템 매개 변수 저장 및 운영 체제를 로드하는 동안 Power-On Self-Test (POST) 기능을 포함합니다. BIOS에는 기본 시스템 구성 설정 또는 특정 시스템 기능을 활성화 하기 위해 사용자가 변경할 수 있는 BIOS 설치 프로그램이 있습니다.
전원이 꺼지면 CMOS에 구성 값을 보존할 수 있도록 메인보드의 배터리가 CMOS에 필요한 전원을 공급합니다.
BIOS 셋업 프로그램에 액세스하려면 전원을 켠 후 POST 동안 <Delete> 키를 누르십시오.
BIOS를 업그레이드하려면 GIGABYTE Q-Flash 또는 @BIOS 유틸리티를 사용하십시오.

- Q-Flash는 사용자가 운영 체제로 들어갈 필요 없이 BIOS를 빠르고 쉽게 업그레이드하거나 백업할 수 있게 합니다.
- @BIOS는 인터넷에서 최신 버전의 BIOS를 검색하여 다운로드하고 BIOS를 업데이트하는 Windows 기반 유틸리티입니다.

- BIOS 플래싱은 잠재적으로 위험하기 때문에 현재 버전의 BIOS를 사용하면서 문제가 없다면 BIOS를 플래시하지 않는 것이 좋습니다. BIOS를 플래시하려면 신중하게 수행하십시오. 부적절한 BIOS 플래싱은 시스템 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 시스템 불안정성이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 꼭 필요한 경우 이외에는 기본 설정값을 수정하지 않는 것이 좋습니다. 설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오. (CMOS 값을 지우는 방법에 대해서는 이 장의 "Load Optimized Defaults(최적화된 기본값 불러오기)" 섹션이나 제1장의 배터리/CMOS 클리어 점퍼에 대한 소개를 참조하십시오.)

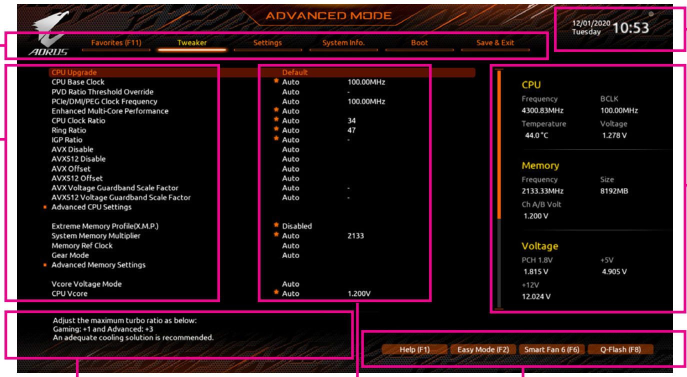
2-1 시작 화면

컴퓨터를 부팅하면 다음과 같은 로고 화면이 나타납니다 .

다음과 같은 2개의 서로 다른 BIOS 모드가 있으며 이 두 가지 모드 사이를 전환하려면 <F2> 키를 사용하면 됩니다.
Easy Mode(간편 모드)를 사용하면 사용자가 현재 시스템 정보를 신속하게 볼 수 있고 최적의 성능을 위해 조정할 수도 있습니다. 간편 모드(Easy Mode)에서는 마우스를 사용하여 구성 항목 사이를 이동할 수 있습니다. 고급 모드에서 자세한 BIOS 설정이 제공됩니다. 키보드의 화살표 키를 눌러 항목 사이를 이동한 다음 <Enter>를 눌러 수락하거나 하위 메뉴에 들어가면 됩니다. 또는 마우스로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

- 시스템이 평소와 같이 안정적이지 않으면 **Load Optimized Defaults** 항목을 선택하여 시스템을 기본값으로 설정하십시오.
- 이 장에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 참조용일 뿐이며 BIOS 버전에 따라 다를 수 있습니다.

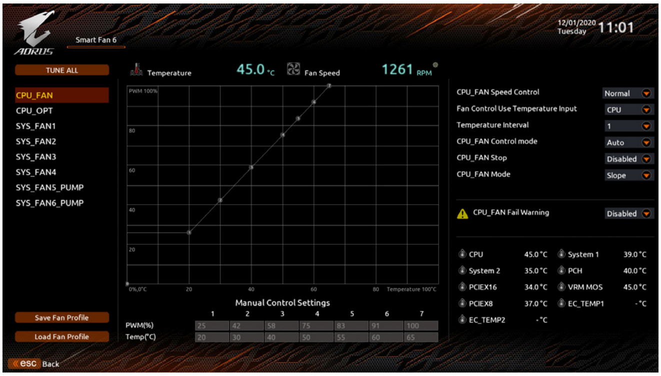
2-2 메인 메뉴



고급 모드 기능 키

<←><→>	선택 표시줄을 이동하여 설치 메뉴를 선택합니다
<↑><↓>	선택 표시줄을 이동하여 메뉴에서 구성 항목을 선택합니다 .
<Enter>/ 더블 클릭	명령을 실행하거나 메뉴를 입력합니다 .
<+>/<Page Up>	숫자 값을 증가시키거나 변경합니다 .
<->/<Page Down>	숫자 값을 감소시키거나 변경합니다 .
<F1>	기능 키의 설명을 표시합니다 .
<F2>	Easy Mode (간편 모드) 로 전환
<F3>	프로필에 현재 BIOS 설정 저장
<F4>	이전에 만든 프로필의 BIOS 설정 로드
<F5>	현재 하위 메뉴에 대해 이전 BIOS 설정을 복원합니다 .
<F6>	스마트 팬 6 화면 표시
<F7>	현재 하위 메뉴에 대해 최적화된 BIOS 기본 설정값을 로드합니다 .
<F8>	Q-Flash 유틸리티에 액세스합니다 .
<F10>	변경 내용을 모두 저장하고 BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다 .
<F11>	즐겨찾기 하위 메뉴로 전환
<F12>	현재 화면을 이미지로 캡처하여 USB 드라이브로 저장합니다 .
<Insert>	즐겨찾기 옵션 추가 또는 제거
<Ctrl>+<S>	설치된 메모리에 관한 정보 화면 표시
<Esc>	주 메뉴 : BIOS 셋업 프로그램을 종료합니다 . 하위 메뉴 : 현재 하위 메뉴를 종료합니다 .

2-3 Smart Fan 6



<F6> 기능 키를 사용하여 빠르게 이 화면으로 전환합니다. 이 화면에서 각 팬 헤드에 대해 팬 속도 관련 설정을 구성하고 시스템/CPU 온도를 모니터링할 수 있습니다.

☞ **TUNE ALL**
현재 설정을 모든 팬 헤더에 적용할 수 있습니다.

☞ **Temperature**
선택한 대상 영역의 현재 온도를 표시합니다.

☞ **Fan Speed**
현재 팬/펌프 속도를 표시합니다.

☞ **Flow Rate**
수냉 시스템의 유량을 표시합니다. **Fan Speed**에서 <Enter>를 눌러 이 기능으로 전환합니다.

☞ **Fan Speed Control**
팬 속도 제어 기능의 사용 여부를 결정하고 팬 속도를 조절할 수 있습니다.

- ▸▸ Normal: 팬이 온도에 따라 각기 다른 속도로 작동할 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 따라 시스템 정보 뷰어를 사용하여 팬 속도를 조정할 수 있습니다. (기본값)
- ▸▸ Silent: 팬이 저속으로 작동할 수 있습니다.
- ▸▸ Manual: 곡선 노드를 끌어 팬 속도를 조정할 수 있습니다. 또는 **EZ Tuning** 기능을 사용할 수 있습니다. 노드 위치를 조정한 후 **Apply**를 눌러 곡선의 경사를 자동으로 측정합니다.
- ▸▸ Full Speed: 팬을 최고 속도로 작동할 수 있습니다.

☞ **Fan Control Use Temperature Input**
팬 속도 제어에 사용할 기준 온도를 선택할 수 있습니다.

☞ **Temperature Interval**
팬 속도를 변경할 온도 간격을 선택할 수 있습니다.

☞ **FAN/PUMP Control Mode**

- ▸▸ Auto: BIOS가 자동으로 설치된 팬 유형을 감지하도록 하여 최적의 제어 모드를 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Voltage: Voltage(전압) 모드는 3핀 팬/펌프용으로 권장됩니다.
- ▸▸ PWM: PWM 모드는 4핀 팬/펌프용으로 권장됩니다.

- **FAN/PUMP Stop**
  팬/펌프 중지 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 온도 곡선을 사용하여 온도 제한을 설정할 수 있습니다. 온도가 제한값보다 낮아지면 팬 또는 펌프가 작동을 멈춥니다. (기본값: Disabled)

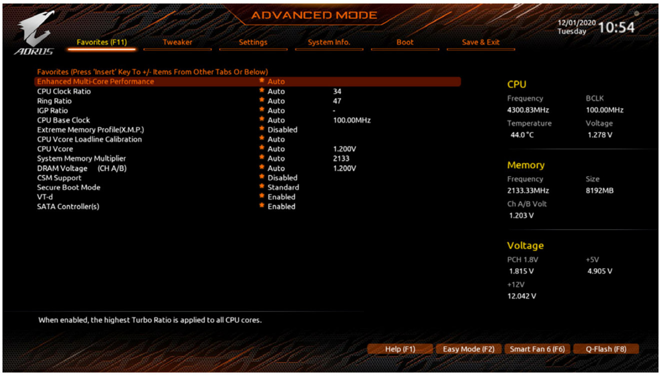
- **FAN/PUMP Mode**
  팬의 작동 모드를 설정할 수 있습니다.
  - Slope 온도에 따라 팬 속도를 선형으로 조정합니다. (기본값)
  - Stair 온도에 따라 팬 속도를 계단식으로 조정합니다.

- **FAN/PUMP Fail Warning**
  팬/펌프가 연결되지 않았거나 오류를 일으키면 시스템이 경고음을 내도록 합니다. 이런 일이 발생하면 팬/펌프 상태 또는 팬/펌프 연결 상태를 확인하십시오. (기본값: Disabled)

- **Save Fan Profile**
  이 기능은 현재 설정을 프로필로 저장할 수 있게 합니다. BIOS에서 프로필을 저장하거나 **Select File in HDD/FDD/USB**를 선택하여 프로필을 저장 장치에 저장할 수 있습니다.

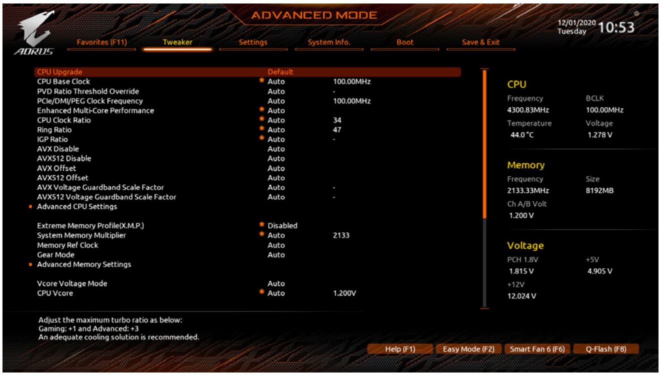
- **Load Fan Profile**
  이 기능을 사용하면 BIOS 설정을 번거롭게 다시 구성하지 않고도 이전에 저장한 BIOS 프로필을 로드할 수 있습니다. 또는 **Select File in HDD/FDD/USB**를 선택하여 저장 장치에서 프로필을 로드할 수 있습니다.

2-4 Favorites (F11) (즐겨찾기 (F11))



자주 사용하는 옵션을 즐겨찾기로 설정하고, <F11> 키를 사용하여 즐겨찾기 옵션이 모두 위치해 있는 페이지로 신속하게 전환할 수 있습니다. 즐겨찾기 옵션을 추가하거나 제거하려면 원래의 페이지로 이동하여 해당 옵션에서 <Insert>를 누르십시오. 옵션이 "즐겨찾기"로 설정된 경우 옵션에 별 기호가 표시됩니다.

2-5 Tweaker (트위커)



사용자가 설정한 오버클록/과전압의 안정적인 작동 여부는 전체 시스템 구성에 달려 있습니다. 오버클록/과전압을 잘못 수행할 경우 CPU, 칩셋 또는 메모리가 손상되고 이런 부품의 유효 수명을 단축하게 할 수 있습니다. 이 페이지는 고급 사용자 전용이며 시스템 불안정이나 다른 예기치 않은 결과를 방지하려면 기본 설정값을 수정하지 말 것을 권합니다. (설정을 부적절하게 수정하면 시스템을 부팅하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 다시 설정해 보십시오.)

☞ **CPU Upgrade**

CPU 주파수를 설정할 수 있습니다. 최종 결과는 사용 중인 CPU에 따라 다를 수 있습니다. 옵션은: 기본, 게이밍 프로필, 고급 프로필. (기본값: 기본값)

☞ **CPU Base Clock**

CPU 기본 클록을 0.01 MHz 단위로 수동 설정할 수 있습니다. (기본값: Auto)
중요: CPU 주파수는 CPU 규격에 따라서 설정하는 것이 좋습니다.

☞ **PVD Ratio Threshold Override** (주의)

매우 높은 DCO 주파수로 인해 부분적으로 발생하는 "PLL 밴딩" 조건을 줄임으로써 극단적인 BCLK OC에서 성능을 개선할지 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **Enhanced Multi-Core Performance**

CPU를 Turbo 1C 속도로 실행할 것인지 여부를 결정합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU Clock Ratio**

설치된 CPU의 클록 비율을 수정할 수 있습니다. 조정 가능한 범위는 설치된 CPU에 따라 다릅니다.

☞ **Ring Ratio**

CPU 언코어 비율을 설정할 수 있습니다. 조절 가능 범위는 사용 중인 CPU에 따라 다릅니다. (기본값: Auto)

☞ **IGP Ratio** (주의)

그래픽 비율을 설정할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **AVX Disable** (주의)

AVX를 지원하는 CPU에서 AVX 명령어 세트를 비활성화할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **AVX512 Disable** (주의)

AVX-512를 지원하는 CPU에서 AVX-512 명령어 세트를 비활성화할 수 있습니다. (기본값: Auto)

(주의) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치한 경우에만 표시됩니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **AVX Offset** (주의)
프로세서가AVX 워크로드를 실행할 때 CPU 클록 비율은 원하는AVX 오프셋 값만큼 감소합니다. 예를 들어 값을 3으로 설정하면 AVX 명령어를 실행할 때 CPU 클록 비율이 3만큼 감소합니다. (기본값: Auto)

☞ **AVX512 Offset** (주의)
프로세서가 AVX-512 워크로드를 실행할 때 CPU 클록 비율은 원하는 AVX-512 오프셋 값만큼 감소합니다. 예를 들어 값을 3으로 설정한 경우(값이 AVX 오프셋 값보다 크거나 같아야 함) AVX-512 명령어를 실행할 때 CPU 클럭 비율이 3만큼 감소합니다. (기본값: Auto)

☞ **AVX Voltage Guardband Scale Factor** (주의)
표준 AVX 전압을 낮출 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **AVX512 Voltage Guardband Scale Factor** (주의)
표준 AVX-512 전압을 낮출 수 있습니다. (기본값: Auto)

■ **Advanced CPU Settings (고급 CPU 설정)**

☞ **Core Fused Max Core Ratio** (주의)
각 코어의 최대 주파수를 표시합니다.

☞ **CPU Over Temperature Protection** (주의)
TJ 최대 오프셋 값을 미세 조정할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **FCLK Frequency for Early Power On** (주의)
FCLK 주파수를 설정할 수 있습니다. 옵션은: Normal(800MHz), 1GHz, 400MHz. (기본값: 1GHz)

☞ **Hyper-Threading Technology**
이 기능을 지원하는 Intel® CPU를 사용할 경우 멀티스레딩 기술을 사용으로 설정할지 여부를 결정할 수 있습니다. 이 기능은 다중 프로세서 모드를 지원하는 운영 체제에서만 작동합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **No. of CPU Cores Enabled**
Intel® 멀티 코어 CPU (CPU 코어 번호는 CPU에 따라 다름)에서 CPU 코어 번호를 선택할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Intel(R) Speed Shift Technology (Intel® Speed Shift Technology)** (주의)
Intel® Speed Shift Technology를 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 이 기능을 사용하기로 설정하면 프로세서가 자체 작동 주파수를 더욱 신속하게 증가시켜 시스템 반응성을 개선할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **CPU Thermal Monitor** (주의)
CPU 과열 보호 기능인 Intel® Thermal Monitor 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 CPU가 과열되었을 때 CPU 코어 주파수와 전압이 감소합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Ring to Core offset (Down Bin)**
CPU 링 비율 자동 다운 기능의 사용 안 함 여부를 결정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **CPU EIST Function** (주의)
Enhanced Intel® Speed Step Technology(EIST)의 사용 여부를 설정합니다. Intel® EIST 기술은 CPU 부하에 따라 CPU 전압과 코어 주파수를 능동적이고 효과적으로 낮추어 평균 소비 전력과 열 생성을 감소시킵니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Race To Halt (RTH)** (주의)**/Energy Efficient Turbo** (주의)
CPU 절전 관련 설정을 활성화하거나 비활성화합니다. (기본값: Auto)

(주의) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치한 경우에만 표시됩니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **Intel(R) Turbo Boost Technology (주의)**
Intel® CPU Turbo Boost 기술 사용 여부를 결정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0 (주의)**
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0을 활성화하거나 비활성화합니다. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 에서는 시스템이 프로세서 최상의 성능 코어를 식별할 수 있고 사용자가 수동으로 가장 중요한 작업 부하를 이 코어에 할당할 수 있습니다. 또한 성능 최적화를 위해 각 코어의 주파수를 개별적으로 조정할 수도 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **CPU Flex Ratio Override**
CPU 플렉스 비율을 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다. **CPU Clock Ratio**이 **Auto**로 설정되어 있을 경우, CPU의 최대 클록 비율은 **CPU Flex Ratio Settings** 값을 기준으로 정해지게 됩니다. (기본값: Disabled)

☞ **CPU Flex Ratio Settings**
CPU 플렉스 비율을 설정할 수 있습니다. 조정 가능 범위는 CPU별로 다를 수 있습니다.

☞ **Frequency Clipping TVB (주의)**
Thermal Velocity Boost에 의해 시작된 자동 CPU 주파수 감소를 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Voltage reduction initiated TVB (주의)**
Thermal Velocity Boost에 의해 시작된 자동 CPU 전압 감소를 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

▼ **Active Turbo Ratios (액티브 터보 비율)**

☞ **Turbo Ratio (Core Active)**
다른 활성 코어의 CPU 터보 비율을 설정할 수 있습니다. **Auto**은 CPU 터보 비율을 CPU 사양에 따라 설정합니다. 이 항목은 **Active Turbo Ratios**가 **Manual**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

▼ **Per Core HT Disable Setting (코어별 HT 사용 안 함 설정)**

☞ **HT Disable (주의)**
각 CPU 코어에 대한 HT 기능의 사용 안 함 여부를 결정할 수 있습니다. 이 항목은 **Per Core HT Disable Setting** 항목이 **Manual**으로 설정되어 있을 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

▼ **C-States Control (C 상태 제어)**

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E)**
시스템 정지 상태에서 CPU 절전 기능인 Intel® CPU Enhanced Halt(C1E) 기능 사용 여부를 설정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **C3 State Support (주의)**
시스템 정지 상태에서 CPU가 C3 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C3 상태는 C1보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **C6/C7 State Support**
시스템 정지 상태에서 CPU가 C6/C7 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C6/C7 상태는 C3보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

(주의) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치한 경우에만 표시됩니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.

☞ **C8 State Support** (주의 1)
시스템 정지 상태에서 CPU가 C8 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C8 상태는 C6/C7보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **C10 State Support** (주의 1)
시스템 정지 상태에서 CPU가 C10 모드로 들어갈지 여부를 결정합니다. 사용하도록 설정하면 시스템 정지 상태 동안 CPU 코어 주파수와 전압이 줄어 소비 전력이 감소합니다. C10 상태는 C8보다 절전 기능이 향상된 상태입니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **Package C State Limit** (주의 1)
프로세서에 대한 C-상태 한계를 지정할 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. 이 항목은 **C-States Control**이 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

▼ **Turbo Power Limits (터보 전력 제한)**
CPU 터보 모드에 대한 전력 제한을 설정할 수 있습니다. CPU 전력 소비량이 설정된 전력 한계를 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전력을 줄입니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 전력 제한을 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time**
CPU/플랫폼/메모리 터보 모드에 대한 전원 한계 및 지정된 전원 한계에서 작동하는 데 걸리는 시간을 설정할 수 있습니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 전력 제한을 설정합니다. 이 항목은 **Turbo Power Limits**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **Core Current Limit (Amps)**
CPU 터보 모드에 대한 전류 제한을 설정할 수 있습니다. CPU 전류가 설정된 전류 한계를 초과하면 CPU가 자동으로 코어 주파수를 감소시켜 전류를 줄입니다. **Auto**는 CPU 사양에 따라 전력 제한을 설정합니다. 이 항목은 **Turbo Power Limits**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Auto)

▼ **Turbo Per Core Limit Control** (주의 1)
각 CPU 코어 제한을 개별적으로 제어할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (주의 2)
사용하면 BIOS가 XMP 메모리 모듈에 있는 SPD 데이터를 읽어 메모리 성능을 향상 시킵니다.
- ▸▸ Disabled 이 기능을 사용 안 함으로 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Profile1 프로필 1 설정을 사용합니다.
- ▸▸ Profile2 (주의 2) 프로필 2 설정을 사용합니다.

☞ **System Memory Multiplier**
시스템 메모리 승수를 설정할 수 있습니다. **Auto**는 메모리 SPD 데이터에 따라 메모리 승수를 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Memory Ref Clock**
메모리 참조 클럭을 수동으로 조정할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **Memory Odd Ratio (100/133 or 200/266)** (주의 1)
Enabled로 설정하면 QCLK이 ODD 주파수로 실행할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **Gear Mode** (주의 2)
최대 OC 주파수 전위 간섭을 개선할 수 있습니다. (기본값: Auto)

(주의 1) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치한 경우에만 표시됩니다. Intel® CPU의 고유 기능에 대한 자세한 정보는 Intel 웹 사이트를 방문하십시오.
(주의 2) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU와 메모리 모듈을 설치한 경우에만 표시됩니다.

■ **Advanced Memory Settings (고급 메모리 설정)**

☞ **Memory Multiplier Tweaker**
다른 메모리 레벨을 자동으로 미세하게 조정합니다. (기본값: Auto)

☞ **Channel Interleaving**
메모리 채널 인터리빙을 사용하도록 또는 사용하지 않도록 설정합니다. **Enabled**로 설정하면 시스템이 메모리의 다른 채널에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Rank Interleaving**
메모리 채널 인터리빙 사용 여부를 설정합니다. **Enabled**로 설정하면 시스템이 메모리의 다른 순위에 동시에 액세스하여 메모리 성능과 안정성을 높일 수 있습니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **Memory Boot Mode**
메모리 감지 및 트레이닝 방법을 제공합니다.

▸▸ Auto	BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값)
▸▸ Normal	BIOS가 자동으로 메모리 학습을 수행합니다. 시스템이 불안정해지거나 부팅할 수 없는 상태가 되는 경우, CMOS 값을 지우고 보드를 기본값으로 초기화하는 방법을 시도해보십시오. (CMOS 값을 지우는 방법은 제1장의 배터리/CMOS 점퍼 지우기 지침을 참조하십시오.)
▸▸ Enable Fast Boot	특정 기준에서 메모리 감지 및 학습을 건너뛰어 메모리를 더욱 빠르게 부팅합니다.
▸▸ Disable Fast Boot	부팅할 때마다 메모리를 감지하고 학습합니다.

☞ **Realtime Memory Timing**
BIOS 단계 후 메모리 타이밍을 미세 조정할 수 있습니다. (기본값: Auto)

☞ **Memory Enhancement Settings**
다음과 같은 몇가지 메모리 성능 향상 설정을 제공합니다. 자동, Relax OC, 향상된 안정성, 보통(기본 성능), 향상된 성능, 고주파수, 고밀도 및 DDR-4500+. (기본값: Auto)

☞ **Memory Channel Detection Message**
메모리가 최적의 메모리 채널에 설치되지 않을 경우 경고 메시지를 표시할지 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

■ **SPD Info (SPD 정보)**
설치된 메모리에 관한 정보를 화면에 표시할 수 있습니다.

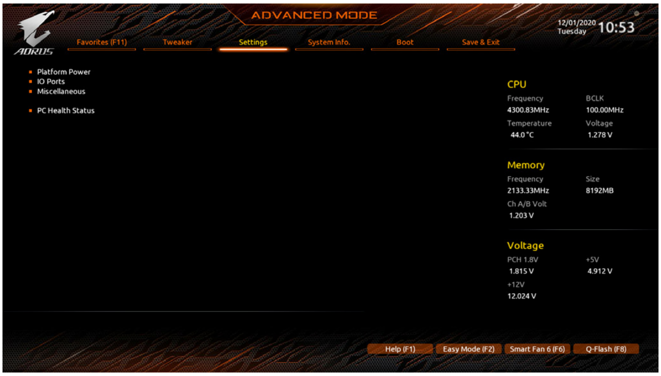
■ **Memory Channels Timings (메모리 채널 타이밍)**

▼ **Channels Standard Timing Control, Channels Advanced Timing Control, Channels Misc Timing Control (채널 표준 타이밍 제어, 채널 고급 타이밍 제어, 채널 기타 타이밍 제어)**
이 섹션에서는 메모리 타이밍 설정을 제공합니다. 주의: 메모리 타이밍을 변경한 후에는 시스템이 불안정하거나 부팅 시 오류가 발생할 수 있습니다. 이런 경우 최적값을 로딩하여 기본 값으로 보드를 재설정하거나 CMOS 값을 삭제하십시오.

☞ **Vcore Volatge Mode/CPU Vcore/Dynamic Vcore(DVID)/BCLK Adaptive Voltage/CPU Graphics Voltage (VAXG)/DRAM Voltage (CH A/B)/CPU VCCIO/CPU VCCIO2/CPU System Agent Voltage/VCC Substained/VCCPLL OC/VCCVTT/ VCC STG/ VCC18 PCH/VCC1V8P**
이 항목에서 CPU Vcore와 메모리 전압을 조정할 수 있습니다.

■ **Advanced Voltage Settings (고급 전압 설정)**
이 하위 메뉴에서 로드-라인 보정 레벨, 과전압 보호 레벨, 과전압 보호 레벨 및 과전류 보호 레벨을 구성할 수 있습니다.

2-6 Settings (설정)



■ Platform Power (플랫폼 전원)

☞ Platform Power Management

액티브 상태 전원 관리 기능(ASPM)을 활성화 또는 비활성화합니다. (기본값: Disabled)

☞ PEG ASPM

CPU PEG 버스에 연결된 장치에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Platform Power Management**이 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ PCH ASPM

칩셋의 PCI Express 버스에 연결된 장치에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Platform Power Management**이 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ DMI ASPM

DMI 링크의 CPU 측과 칩셋 측에 대해 ASPM 모드를 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Platform Power Management**가 **Enabled**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ ErP

시스템이 S5(종료) 상태에서 최소 전력을 사용하게 할 것인지 결정합니다. (기본값: Disabled)
주의: 이 항목을 **Enabled**로 설정하면 알람에 의한 재시작 기능을 사용할 수 없습니다.

☞ Soft-Off by PWR-BTTN

전원 버튼을 사용하여 MS-DOS 모드에서 컴퓨터를 끄는 방법을 구성합니다.
- ▸▸ Instant-Off　전원 버튼을 누르면 시스템이 즉시 꺼집니다. (기본값)
- ▸▸ Delay 4 Sec.　전원 버튼을 4초 동안 누르면 시스템이 꺼집니다. 전원 버튼을 4초 미만 동안 누르면 시스템이 일시 중단 모드로 들어갑니다.

☞ Resume by Alarm

원하는 시각에 시스템 전원을 켤지를 결정합니다. (기본값: Disabled)
사용하도록 설정하는 경우 날짜와 시간은 다음과 같이 설정하십시오:
- ▸▸ Wake up day: 매일 특정 시각 또는 매월 특정 날짜에 시스템을 켭니다.
- ▸▸ Wake up hour/minute/second: 시스템 전원이 자동으로 켜지는 시각을 설정하십시오.

주의: 이 기능을 사용할 때는 부적절한 운영 체제 종료 또는 AC 전원 제거를 피하십시오. 그렇지 않으면 설정이 적용되지 않을 수 있습니다.

☞ Power Loading

더미 로드를 활성화 또는 비활성화합니다. 전원 공급이 낮은 로드에 있을 경우 자기 보호가 활성화되어 종료시키거나 오류를 발생시킵니다. 이런 경우 **Enabled**로 설정합니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **RC6(Render Standby)**
전력 소모량을 줄이기 위해 온보드 그래픽의 대기 모드 상태 설정 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

☞ **AC BACK**
AC전원공급이 비정상적으로 중단된 후, 다시 전원이 공급된 시스템의 상태를 결정합니다.
- Memory AC 전원이 복구되면 시스템이 마지막으로 알려진 활성 상태로 돌아갑니다.
- Always On AC 전원이 다시 들어오면 시스템이 켜집니다.
- Always Off AC 전원이 다시 들어와도 시스템이 꺼진 상태로 있습니다. (기본값)

■ IO Ports (IO 포트)

☞ **Initial Display Output**
설치된 PCI Express 그래픽 카드 또는 온보드 그래픽에서 모니터 디스플레이의 최초 시작을 지정합니다.
- IGFX (주의) 온보드 그래픽을 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- PCIe 1 Slot PCIEX16 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다. (기본값)
- PCIe 2 Slot PCIEX8 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.
- PCIe 3 Slot PCIEX4 슬롯의 그래픽 카드를 첫 번째 디스플레이로 설정합니다.

이 항목은 **CSM Support**가 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Internal Graphics**
온보드 그래픽 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Auto)

☞ **DVMT Pre-Allocated**
온보드 그래픽 메모리 크기를 설정할 수 있습니다. (기본값: 64M)

☞ **DVMT Total Gfx Mem**
온보드 그래픽의 DVMT 메모리 크기를 할당할 수 있습니다. 옵션은: 128M, 256M, MAX. (기본값: 256M)

☞ **Aperture Size**
그래픽 카드에 할당할 수 있는 시스템 메모리의 최대량을 설정할 수 있습니다. 옵션은: 128MB, 256MB, 512MB, 1024MB 및 2048MB. (기본값: 256MB)

☞ **PCIE Bifurcation Support**
PCIEX16 슬롯의 대역폭 분할 방식을 결정할 수 있습니다. 옵션: Auto, PCIE x8/x8, PCIE x8/x4/x4. (기본값: Auto)

☞ **OnBoard LAN Controller**
온보드 LAN 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)
온보드 LAN을 사용하는 대신 타사 애드인 LAN 카드를 설치하려면 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

☞ **Audio Controller**
온보드 오디오 기능을 사용 또는 사용하지 않도록 설정합니다. (기본값: Enabled)
온보드 오디오를 사용하지 않고 대신 타사 애드인 오디오 카드를 설치하고자 하는 경우, 이 항목을 **Disabled**로 설정하십시오.

☞ **Above 4G Decoding**
4 GB 이상 용량의 주소 공간에 디코딩할 64 비트 성능 장치를 사용하도록 설정하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다(사용자의 시스템이 64 비트 PCI 디코딩을 지원하는 경우만 해당). 고급 그래픽 카드가 2개 이상 설치되어 있고 운영 체제로 들어갔을 때(제한된 4 GB 메모리 주소 공간으로 인해) 이 그래픽 카드의 드라이버를 시작할 수 없을 경우 **Enabled**로 설정하십시오. (기본값: Disabled)

☞ **IOAPIC 24-119 Entries**
이 기능을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. (기본값: Enabled)

(주의) 이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치한 경우에만 표시됩니다.

APP Center Download & Install Configuration

APP Center Download & Install
운영 체제에 들어간 후에 GIGABYTE APP Center의 자동 다운로드 및 설치 여부를 결정할 수 있습니다. APP Center를 설치하기 전 시스템이 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오. (기본값: Enabled)

USB Configuration (USB 구성)

Legacy USB Support
MS-DOS에서 USB 키보드/마우스를 사용할 수 있습니다. (기본값: Enabled)

XHCI Hand-off
XHCI Hand-off를 지원하지 않는 운영 체제에 대한 XHCI Hand-off 기능 사용 여부를 결정합니다. (기본값: Enabled)

USB Mass Storage Driver Support
USB 저장 장치 지원의 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

Mass Storage Devices
연결된 USB 대용량 장치 목록을 표시합니다. 이 항목은 USB 저장소 장치를 설치한 경우에만 표시됩니다.

Network Stack Configuration (네트워크 스택 구성)

Network Stack
Windows 배포 서비스 서버에서 OS를 설치하는 것과 같이, GPT 포맷 OS를 설치하기 위해 네트워크를 통한 부팅을 비활성화하거나 활성화합니다. (기본값: Disabled)

IPv4 PXE Support
IPv4 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

IPv4 HTTP Support
IPv4에 대한 HTTP 부팅 지원을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

IPv6 PXE Support
IPv6 PXE 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

IPv6 HTTP Support
IPv6에 대한 HTTP 부팅 지원을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

PXE boot wait time
<Esc>를 눌러 PXE 부팅을 중단하기 전까지 대기하는 시간을 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. (기본값: 0)

Media detect count
미디어 존재를 확인할 횟수를 설정할 수 있습니다. 이 항목은 **Network Stack**이 사용하도록 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다. (기본값: 1)

NVMe Configuration (NVMe 구성)
설치된 경우 M.2 NVME PCIe SSD에 대한 정보를 표시합니다.

SATA And RST Configuration (SATA 및 RST 구성)

SATA Controller(s)
통합 SATA 컨트롤러 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **SATA Mode Selection**

칩셋에 통합된 SATA 컨트롤러에 대한 RAID 사용 여부를 설정하거나 SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다.

- Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration　SATA 컨트롤러에 대한 RAID를 활성화합니다.
- AHCI　SATA 컨트롤러를 AHCI 모드로 구성합니다. AHCI (고급 호스트 컨트롤러 인터페이스)는 저장 장치 드라이버가 고유 명령 대기열 및 핫 플러그와 같은 고급 직렬ATA기능을 사용하도록 설정할 수 있게 하는 인터페이스 규격입니다. (기본값)

☞ **Aggressive LPM Support**

칩셋 SATA 컨트롤러에 대한 절전 기능, ALPM(어그레시브 링크 저원 관리)의 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Port 0/1/2/3/4/5**

각 SATA 포트 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

☞ **SATA Port 0/1/2/3/4/5 DevSlp**

연결된 SATA 장치를 절전 모드로 전환할지 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

☞ **Hot plug**

각 SATA 포트에 대해 핫 플러그 성능 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Configured as eSATA**

외부 SATA 장치 지원을 활성화 또는 비활성화합니다.

■ **Intel(R) Ethernet Controller (Intel(R) 이더넷 컨트롤러)**

이 하위 메뉴는 LAN 구성이나 구성 옵션 관련 정보를 제공해줍니다.

■ **Miscellaneous (기타)**

☞ **LEDs in System Power On State**

시스템이 켜질 때 메인보드 LED 조명을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

- Off　시스템이 켜질 때 선택된 조명 모드가 비활성화됩니다.
- On　시스템이 켜질 때 선택된 조명 모드가 활성화됩니다. (기본값)

☞ **LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States**

시스템 S3/S4/S5 상태에서 메인보드 LED의 조명 모드를 설정할 수 있습니다.

이 항목은 **LEDs in System Power On State**가 **On** 으로 설정되었을 때 구성할 수 있습니다.

- Off　시스템이 S3/S4/S5 상태로 전환되면 선택된 조명 모드가 비활성화됩니다.(기본값)
- On　시스템이 S3/S4/S5 상태로 전환되면 선택된 조명 모드가 활성화됩니다.

☞ **RST_SW(MULTIKEY) (RST_SW 버튼의 기능성)**

- Set this button to HW Reset　이 버튼을 사용하여 시스템을 초기화합니다.(기본값)
- Set this button to Switch LED On/Off　이 버튼을 사용하여 메인보드 LED를 켜거나 끕니다.
- Set this button to Enter BIOS Setup　이 버튼을 사용하여 BIOS 설정을 시작합니다.
- Set this button to Boot on Safe Mode　이 버튼을 사용하여 안전 모드에서 시스템을 부팅합니다.

☞ **Onboard DB Port LED**

시스템이 켜질 때 메인보드 디버그 LED의 LED 조명을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. (기본값: On)

☞ **Intel Platform Trust Technology (PTT)**

Intel® PTT 기술의 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Disabled)

☞ **3DMark01 Enhancement**

일부 레거시 벤치마크 성능 향상 여부를 결정할 수 있습니다. (기본값: Disabled)

(주의)　이 항목은 이 기능을 지원하는 CPU를 설치한 경우에만 표시됩니다.

☞ **CPU PCIe Link Speed**

ACPU 제어 방식의 PCI Express 슬롯의 작동 모드를 Gen 1, Gen 2, Gen 3 또는 Gen 4(주의)로 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **PCH PCIe Link Speed**

칩셋 제어 방식의 PCI Express 슬롯의 작동 모드를 Gen 1, Gen 2 또는 Gen 3으로 설정할 수 있습니다. 실제 작동 모드는 각 슬롯의 하드웨어 사양에 따릅니다. **Auto**를 선택하면 BIOS가 이 설정을 자동으로 구성합니다. (기본값: Auto)

☞ **VT-d**

Directed I/O에 대한 Intel® Virtualization Technology 사용 여부를 설정합니다. (기본값: Enabled)

■ **Trusted Computing (신뢰할 수 있는 컴퓨팅)**

신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM) 사용여부를 설정합니다.

■ **PC Health Status (PC 작동 상태)**

☞ **Reset Case Open Status**

- ▸▸ Disabled　이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 유지하거나 지웁니다. (기본값)
- ▸▸ Enabled　이전 PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 지우고 다음 번에 부팅할 때 **Case Open** 필드에 "No(아니요)"가 표시됩니다.

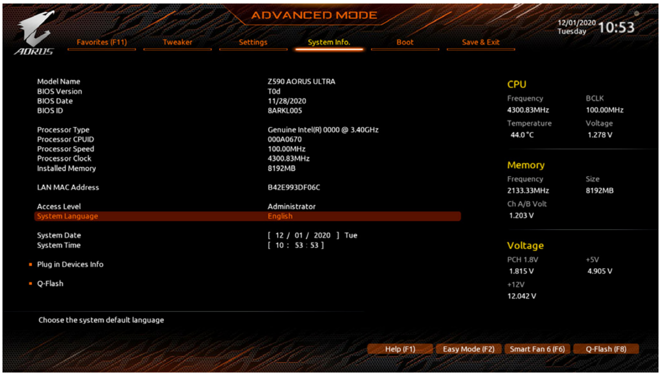
☞ **Case Open**

메인보드 CI header에 연결된 PC 케이스(샤시) 침입 감지 장치의 감지 상태를 표시합니다. 시스템 PC 케이스(샤시) 덮개가 제거되면 이 필드에 "Yes"가 표시됩니다. 그렇지 않으면 "No"가 표시됩니다. PC 케이스(샤시) 침입 상태 기록을 지우려면 **Reset Case Open Status**를 **Enabled**로 설정하고 설정을 CMOS에 저장한 후 시스템을 다시 시작하십시오.

☞ **CPU Vcore/CPU VCCSA/CPU VCCIO/DDRVtt A/B/DRAM Channel A/B Voltage/DDRVpp A/B/+3.3V/+5V/PCH 1.8V/+12V/CPU VAXG**

현재 시스템 전압을 표시합니다.

2-7 System Info. (시스템 정보)



이 섹션에서는 메인보드 모델 및 BIOS 버전 정보를 제공합니다. 또한 BIOS에 사용할 기본 언어를 선택하고 시스템 시간을 수동으로 설정할 수 있습니다.

☞ **Access Level**
사용하는 비밀번호 보호 유형에 따라 현재 액세스 레벨을 표시합니다. (비밀번호를 설정하지 않으면 기본 값은 **Administrator** 입니다.) 관리자 레벨은 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있으며, 사용자 레벨은 전체가 아닌 일부 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

☞ **System Language**
BIOS에서 사용할 기본 언어를 선택합니다.

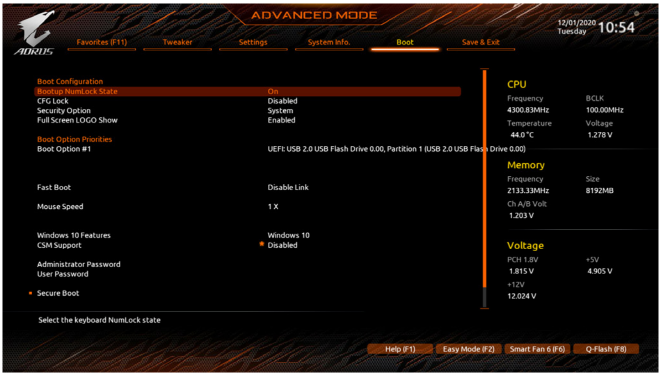
☞ **System Date**
시스템 날짜를 설정합니다. 날짜 형식은 요일(읽기 전용), 월, 일, 년도입니다. <Enter>를 눌러 월, 일, 년도 필드를 전환하고 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 값을 설정합니다.

☞ **System Time**
시스템 시간을 설정합니다. 시간 형식은 시, 분, 초입니다. 예를 들어, 오후 1시는 13:00:00입니다. <Enter>를 눌러 시간, 분, 초 필드를 전환하고 <Page Up> 또는 <Page Down> 키로 값을 설정합니다.

■ **Plug in Devices Info (플러그인 장치 정보)**
PCI Express 그리고 설치되어 있는 경우 M.2 장치에 대한 정보를 화면에 표시할 수 있습니다.

■ **Q-Flash**
Q-Flash 유틸리티에 액세스해서 BIOS를 업데이트하거나 현재 BIOS 구성을 백업할 수 있습니다.

2-8 Boot (부팅)



☞ **Bootup NumLock State**

POST 후에 키보드의 숫자 키패드에 있는 Numlock 기능 사용 여부를 정합니다. (기본값: On)

☞ **CFG Lock**

MSR 0xE2 잠금을 활성화하거나 비활성화합니다. (기본값: Disabled)

☞ **Security Option**

시스템이 부팅할 때마다 암호가 필요한지 아니면 BIOS 셋업으로 들어갈 때만 필요한지를 지정합니다. 이 항목을 구성한 후 **Administrator Password/User Password** 항목에서 비밀번호를 설정하십시오.

- ►► Setup　　비밀번호는 BIOS 설치 프로그램에 들어갈 때만 필요합니다.
- ►► System　　시스템을 부팅할 때 및 BIOS 설치 프로그램에 들어갈 때 비밀번호가 필요합니다. (기본값)

☞ **Full Screen LOGO Show**

시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 표시할지를 결정할 수 있습니다. **Disabled**는 시스템이 시작할 때 GIGABYTE 로고를 건너 뜁니다. (기본값: Enabled)

☞ **Boot Option Priorities**

사용 가능한 장치 중에서 전체적인 부팅 순서를 지정합니다. GPT 포맷을 지원하는 이동식 스토리지 장치의 경우 부팅 장치 목록에 "UEFI:"문자열이 접두어로 표시됩니다. GPT 분할을 지원하는 운영 체제에서 부팅하려면 "UEFI:" 문자열이 접두사로 붙은 장치를선택하십시오. 또는 Windows 10 64비트와 같이 GPT 분할을 지원하는 운영 체제에 설치하고자 하는 경우, Windows 10 64비트 설치 디스크가 포함된 광학 드라이브이면서 "UEFI:" 문자열이 접두사로 붙어 있는 것을선택하십시오.

☞ **Fast Boot**

운영 체제 부팅 시간을 단축해주는 빠른 부팅 옵션의 사용 여부를 설정합니다. **Ultra Fast** 옵션을 이용하면 부팅 속도를 최대한 줄일 수 있습니다. (기본값: Disable Link)

☞ **SATA Support**

- ►► Last Boot SATA Devices Only　이전 부팅 드라이브만 제외하고 모든 SATA 장치를 사용 안 함으로 설정한 뒤 OS 부팅 프로세스가 완료됩니다. (기본값)
- ►► All SATA Devices　모든 SATA 장치가 운영 체제에서 및 POST 중에도 계속 기능합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

VGA Support
사용자가 부팅할 운영 체제의 종류를 선택할 수 있습니다.
- ▸▸ Auto　　레거시 옵션 ROM만 사용하기로 설정합니다.
- ▸▸ EFI Driver　　EFI 옵션 ROM을 사용하기로 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

USB Support
- ▸▸ Disable Link　　모든 USB 장치를 사용 안 함으로 설정한 다음 OS 부팅 프로세스를 완료합니다.
- ▸▸ Full Initial　　모든 USB 장치가 운영 체제에서 및 POST 중 제 기능을 유지합니다. (기본값)
- ▸▸ Partial Initial　　OS 부팅 과정이 완료되기 전까지 일부 USB 장치를 사용 안 함으로 설정합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다. 이 기능은 **Fast Boot** 가 **Ultra Fast**로 설정된 경우는 사용되지 않습니다.

NetWork Stack Driver Support
- ▸▸ Disable Link　　네트워크에서 부팅을 사용 안 함으로 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Enabled　　네트워크로부터의 부팅을 사용하기로 설정합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

Next Boot After AC Power Loss
- ▸▸ Normal Boot　　AC 전원 복귀에 맞춰 일반 부팅을 사용하기로 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Fast Boot　　AC 전원이 복귀된 후에도 Fast Boot(빠른 부팅) 설정을 유지합니다.

이 항목은 **Fast Boot**이 **Enabled** 또는 **Ultra Fast**로 설정된 경우에만 구성할 수 있습니다.

Mouse Speed
마우스 커서 이동 속도를 설정할 수 있습니다. (기본값: 1 X)

Windows 10 Features
설치할 운영 체제 종류를 선택할 수 있습니다. (기본값: Windows 10)

CSM Support
레거시 PC 부트 프로세스를 지원하는 UEFI CSM (호환성 지원 모듈)의 사용 여부를 설정합니다.
- ▸▸ Disabled　　UEFI CSM을 사용 안 함으로 설정하고 UEFI BIOS 부팅 프로세스만 지원합니다. (기본값)
- ▸▸ Enabled　　UEFI CSM을 사용하도록 설정합니다.

LAN PXE Boot Option ROM
LAN 컨트롤러에 대한 레거시 옵션 ROM 활성화 여부를 선택할 수 있습니다. (기본값: Disabled)
이 항목은 **CSM Support**가 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

Storage Boot Option Control
저장장치 컨트롤러에 대해 UEFI 또는 레거시 옵션 ROM을 사용으로 설정할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다.
- ▸▸ Do not launch　　옵션 ROM을 사용안함으로 설정합니다.
- ▸▸ UEFI　　UEFI 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다.
- ▸▸ Legacy　　레거시 옵션 ROM만 사용하기로 설정합니다. (기본값)

이 항목은 **CSM Support**가 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

Other PCI devices
LAN, 저장장치 및 그래픽 컨트롤러가 아닌 PCI 장치 컨트롤러에 대해 UEFI 또는 레거시 옵션 ROM을 사용으로 설정할 것인지 여부를 선택할 수 있습니다.
- ▸▸ Do not launch　　옵션 ROM을 사용안함으로 설정합니다.
- ▸▸ UEFI　　UEFI 옵션 ROM만 사용하도록 설정합니다. (기본값)
- ▸▸ Legacy　　레거시 옵션 ROM만 사용하기로 설정합니다.

이 항목은 **CSM Support**가 **Enabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Administrator Password**

관리자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호(또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 사용자 암호와는 달리 관리자 암호는 모든 BIOS 설정을 변경할 수 있습니다.

☞ **User Password**

사용자 암호를 구성할 수 있습니다. 이 항목에서 <Enter> 키를 눌러 암호를 입력한 후 <Enter> 키를 누릅니다. 암호 확인을 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호를 다시 입력하고 <Enter> 키를 누르십시오. 시스템이 시작될 때와 BIOS를 설치할 때 관리자 암호(또는 사용자 암호)를 입력해야 합니다. 그러나 사용자 암호는 전체가 아닌 일부 BIOS 설정만 변경할 수 있습니다. 암호를 지우려면 암호 항목을 <Enter> 키로 누르고 암호를 요청하는 메시지가 나타나면 정확한 암호를 먼저 입력하십시오. 새 암호가 표시되면 아무 것도 입력하지 말고 <Enter> 키를 누르십시오. <Enter>를 한 번 더 눌러 확인하십시오.

주의: 사용자 비밀번호를 설정하기 전에, 먼저 관리자 비밀번호를 설정하십시오.

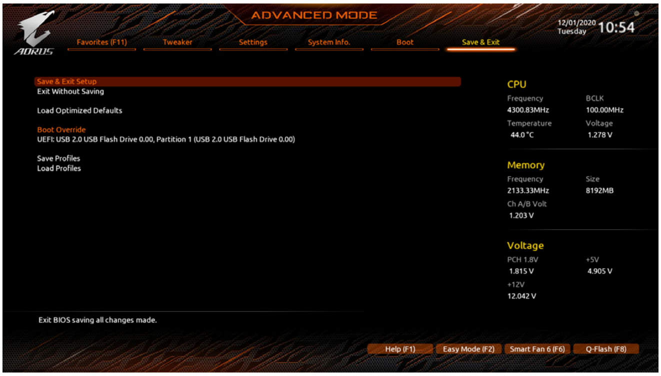
■ **Secure Boot (보안 부팅)**

사용자가 보안 부팅을 활성화하거나 비활성화하고 관련 설정을 구성할 수 있습니다. 이 항목은 **CSM Support**가 **Disabled**로 설정되어 있을 때만 구성할 수 있습니다.

☞ **Preferred Operating Mode**

BIOS 설치로 들어간 후 간편 모드와 고급 모드 중 어느 모드로 시작할지 선택할 수 있습니다. **Auto**의 경우 마지막으로 사용된 BIOS 모드로 시작합니다. (기본값: Auto)

2-9 Save & Exit (저장 및 종료)



- **Save & Exit Setup**

  이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. 변경 내용이 CMOS에 저장되고 BIOS 셋업 프로그램이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

- **Exit Without Saving**

  이 항목에서 <Enter> 키를 누른 다음 **Yes**를 선택합니다. BIOS 셋업에서 변경한 내용이 CMOS에 저장되지 않고 BIOS 셋업이 종료됩니다. BIOS 설치 주 메뉴로 돌아가려면 **No** 또는 <Esc> 키를 누릅니다.

- **Load Optimized Defaults**

  최적의 BIOS 기본 설정값을 로드하려면 이 항목을 <Enter> 키로 누른 후 **Yes** 키를 누릅니다. BIOS 기본 설정값은 시스템이 최적 상태로 작동하는 데 도움이 됩니다. BIOS를 업데이트하거나 CMOS 값을 삭제한 후에는 항상 최적화된 기본값을 로드하십시오.

- **Boot Override**

  선택하면 장치를 즉시 부팅합니다. 선택한 장치에서 <Enter>를 눌러 **Yes** 를 선택하여 확인합니다. 시스템이 자동으로 다시 시작하고 장치에서 부팅합니다.

- **Save Profiles**

  이 기능은 현재 BIOS 설정을 프로필로 저장할 수 있게 합니다. 최대 8개 프로파일을 만드러 Setup Profile 1~ Setup Profile 8로 저장할 수 있습니다. <Enter> 키를 눌러 완료합니다. 또는 **Select File in HDD/FDD/USB**를 선택하여 프로필을 저장장치에 저장할 수 있습니다.

- **Load Profiles**

  시스템이 불안정해지고 사용자가 BIOS 기본 설정을 로드한 경우 이 기능을 사용하여 BIOS 설정을 다시 구성해야 하는 불편을 겪지 않고 이전에 만든 프로필로부터 BIOS 설정을 로드할 수 있습니다. 로드할 프로필을 먼저 선택한 후 <Enter> 키를 눌러 완료하십시오. **Select File in HDD/FDD/USB**를 선택하여 저장 장치에 있는 정상 작동된 프로파일 설정으로 되돌리거나 BIOS에서 자동으로 만든 프로필을 로드할 수 있습니다.

제3장 부록

3-1 RAID 세트 구성

RAID 레벨

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
하드 드라이버 최대 수	≥2	2	≥3	4
어레이 용량	하드 드라이브 수 * 가장 작은 드라이브 크기	가장 작은 드라이브 크기	(하드 드라이브 수-1) * 가장 작은 드라이브 크기	(하드 드라이브 수/2) * 가장 작은 드라이브 크기
결함 허용	아니요	예	예	예

시작하기 전에 다음 항목을 준비하십시오:

- SATA 하드 드라이브 또는 SSD가 2개 이상입니다.(주의 1) (성능을 최적화하려면 동일한 모델과 용량의 하드 드라이브 2개를 사용하는 것이 좋습니다).(주의 2)
- Windows 설치 디스크.
- USB 썸 드라이브 (Thumb drive).

SATA 컨트롤러 구성

A. 하드 드라이브 설정하기

하드 드라이브/SSD를 메인보드의 Intel® 칩셋 제어 커넥터에 설치합니다. 그 다음에 전원 공급 장치의 전원 커넥터를 하드 드라이브에 연결하십시오.

B. BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드 구성하기

시스템 BIOS 셋업에서 SATA 컨트롤러 모드를 반드시 올바르게 구성하십시오.

단계:

컴퓨터를 켜고 POST(전원 구동 시 자체 테스트) 중에 <Delete> 키를 눌러 BIOS 설정으로 갑니다. **Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration**에서 **SATA Controller(s)**가 사용으로 설정되어 있는지 확인하십시오. RAID를 구성하려면 **SATA Mode Selection**을 **Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration**으로 설정합니다. 그런 다음 설정을 저장하고 컴퓨터를 다시 시작합니다. 주의: PCIe SSD를 사용하는 경우 **Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration**에서 **RST Control PCIe Storage Devices** 항목을 **Manual**로 설정하십시오. 그런 다음 사용하는 M.2 커넥터에 따라 해당 **PCIe Storage Dev on Port XX** 항목을 **RST Controlled**로 설정하십시오. 마지막으로 설정을 저장하고 BIOS 설치를 종료합니다.

이 절에서 설명한 BIOS 셋업 메뉴는 사용자 메인보드의 설정과 다를 수 있습니다. 실제 BIOS 설정 메뉴 옵션은 사용자 메인보드와 BIOS 버전에 따라 다릅니다.

C. UEFI RAID 구성

단계:

1. 시스템을 재부팅한 다음 BIOS 셋업으로 다시 들어갑니다. 그런 다음 **Settings\IO Ports\Intel(R) Rapid Storage Technology** 하위 메뉴로 들어갑니다 (그림 3).
2. **Intel(R) Rapid Storage Technology** 메뉴에서 **Create RAID Volume**에 있는 <Enter> 키를 눌러서 **Create RAID Volume** 화면으로 들어갑니다. **Name** 항목에 1자에서 16자 (특수 문자는 사용할 수 없음) 사이의 볼륨 이름을 입력하고 <Enter> 키를 누릅니다. RAID level을 선택합니다. RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 등 네 개의 RAID 레벨이 지원됩니다 (사용할 수 있는 선택 항목은 설치 중인 하드 드라이브 수에 따라 다릅니다). 그런 다음 아래로 화살표 키를 사용해서 **Select Disks**로 이동합니다.

(주의 1) M.2 PCIe SSD는 M.2 SATA SSD 또는 SATA 하드 드라이브에서 RAID 세트를 설정하는 데 사용할 수 없습니다.

(주의 2) M.2 및 SATA 커넥터의 설치 공지는 "내부 커넥터"를 참조하십시오.

3. **Select Disks** 항목에서 RAID 배열에 포함시킬 하드 드라이브를 선택합니다. 선택한 하드 드라이브에서 <Space> 키를 누릅니다(선택한 하드 드라이브는 "X"로 표시됩니다). 스트라이프 블록 크기를 설정합니다. 스트라이프 블록 크기는 4 KB에서 128 KB로 설정할 수 있습니다. 스트라이프 블록 크기를 선택했으면 볼륨 용량을 설정합니다.
4. 용량을 설정한 다음 **Create Volume**으로 이동해서 <Enter> 키를 눌러서 시작합니다.
5. 작업이 끝나면 **Intel(R) Rapid Storage Technology** 화면이 도로 나타납니다. **RAID Volumes** 아래에서 새 RAID 볼륨을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 볼륨에서 <Enter> 키를 눌러 RAID 레벨 관련 정보, 스트라이프 블록 크기, 어레이 이름, 어레이 용량 등을 확인하십시오.

RAID 드라이버 및 운영 체제를 설치합니다.

올바른 BIOS 설정이 완료되면 운영 체제를 설치할 준비가 된 것입니다.
일부 운영 체제에는 RAID 드라이버가 이미 포함되어 있기 때문에, Windows 설치 과정에서 별도의 RAID 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 운영 체제를 설치한 후 GIGABYTE APP Center에서 필요한 모든 드라이버를 설치하여 시스템 성능 및 호환성을 보장할 것을 권장합니다. 운영 체제 설치 중 RAID 드라이버를 추가하려면 다음 단계를 참조하십시오.

1. GIGABYTE 웹사이트로 이동하고, 메인보드 모델의 웹페이지를 탐색하여 **Support\Download\SATA RAID/AHCI** 페이지에 있는 **Intel SATA Preinstall driver** 파일을 다운로드하여 파일의 압축을 풀고 파일을 USB 썸 드라이브에 복사합니다.
2. Windows 설치 디스크로 부팅하여 표준 OS 설치 단계를 실행합니다. 드라이버를 로드하라는 메시지가 표시되면 **Browse**를 선택합니다.
3. 그런 다음 USB 플래시 드라이브를 찾아 드라이버 위치를 선택합니다. **Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller** 를 선택하고 **Next** 를 클릭하여 드라이버를 로드한 다음 OS 설치를 계속합니다.

3-2 Intel® Optane™ Memory and Storage Management 설치하기

단계:
운영 체제를 시작한 후 인터넷이 제대로 연결되었는지, 그리고 GIGABYTE APP Center가 실행되는지 확인하십시오. "Not Installed\New Drivers" 화면에서 **Intel Rapid Storage Technology driver** 을 선택하여 설치합니다. 화면 지시에 따라 계속합니다. 완료되면 시스템을 다시 시작합니다.

A. Intel® Optane™ Memory 활성화하기

A-1: 시스템 요구 사항

1. Intel® Optane™ 메모리
2. Optane™ 메모리는 가속을 위해 용량이 최소 16 GB로서 하드 드라이브/SSD와 같거나 이보다 작아야 합니다.
3. Optane™ 메모리는 기존 RAID 배열을 가속하는 데 사용할 수 없습니다. 가속된 하드 드라이브/SSD는 RAID 배열에 포함시킬 수 없습니다.
4. 가속할 하드 드라이브/SSD는 SATA 하드 드라이브 또는 M.2 SATA SSD여야 합니다.
5. 가속할 하드 드라이브/SSD는 시스템 드라이브 또는 데이터 드라이브일 수 있습니다. 시스템 드라이브는 GPT 포맷을 해야 하고 Windows 10 64-비트 이상의 버전이 설치되어 있어야 합니다. 데이터 드라이브도 GPT 포맷을 해야 합니다.
6. Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration(Optane 시스템 가속 포함 Intel RST 프리미엄) 모드에서 SATA 컨트롤러를 설정해야 합니다.

RAID 어레이 구성에 대한 자세한 내용은 GIGABYTE의 웹사이트를 참조하십시오.

A-2: 설치 지침

1. **Settings\IO Ports\SATA And RST Configuration** 순서로 이동하여 **RST Control PCIe Storage Devices**를 **Manual**로 설정합니다. 그런 다음 Optane™ 메모리를 설치하는 M.2 커넥터에 따라 해당 **PCIe Storage Dev on Port XX** 항목을 **RST Controlled**로 설정하십시오.
2. 운영 체제를 다시 시작한 후 시작 메뉴에서 **Intel® Optane™ Memory and Storage Management** 애플리케이션을 실행합니다. 2개 이상의 Optane™ 메모리를 설치할 경우 사용할 메모리를 선택하십시오. 그런 다음 가속할 드라이브를 선택합니다. **Enable Intel® Optane™ Memory**를 클릭합니다. Optane™ 메모리의 모든 데이터가 지워집니다. 계속하기 전에 반드시 데이터를 백업합니다. 화면 지시에 따라 계속합니다. 완료되면 시스템을 다시 시작합니다.
3. 시작 메뉴에서 **Intel® Optane™ Memory and Storage Management** 애플리케이션을 실행하고 Intel® Optane™ 메모리가 활성화되었는지 확인하십시오.
4. 시스템 드라이브를 가속하려면 특정한 폴더, 파일 또는 애플리케이션을 선택하고 **Intel® Optane™ Memory Pinning** 기능을 사용하여 가속할 수 있습니다. (사용 중인 Optane™ 메모리의 용량이 최소 32 GB여야 합니다.)

- Optane™ 메모리는 M.2 PCIe SSD를 가속하는 데 사용할 수 없습니다.
- Optane™ 메모리가 2개 이상 설치된 경우 이들 중 하나만 선택하여 SATA 기반 부팅 드라이브를 가속할 수 있습니다. 나머지 메모리는 데이터 드라이브로 사용할 수 있습니다.
- Optane™ 메모리를 갑자기 제거하지 마십시오. 그럴 경우 운영 체제가 올바로 작동하지 않게 됩니다.
- Optane™ 메모리를 변경/제거하려면 먼저 **Intel® Optane™ Memory and Storage Management** 애플리케이션을 사용하여 이를 비활성화해야 합니다.
- Optane™ 메모리를 활성화하면 BIOS를 업데이트하더라도 관련 BIOS 설정이 그대로 유지됩니다.

B. 배열 재구축하기

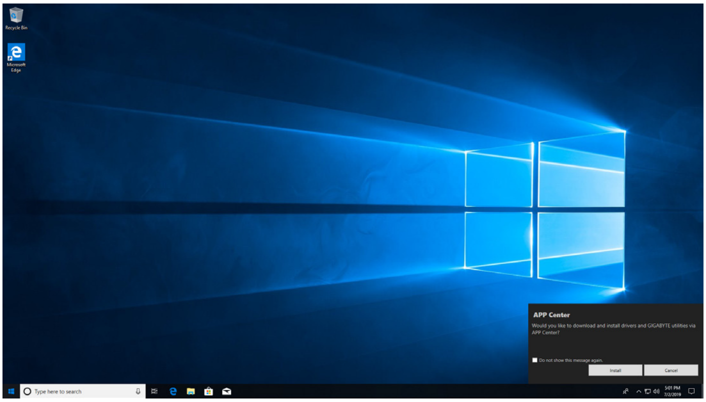
재 빌드는 다른 드라이브에서 하드 드라이브로 데이터를 복원하는 과정입니다. 재 빌드는 RAID 1, RAID 5 또는 RAID 10 배열과 같은 장애 허용 배열에만 적용됩니다. 아래 절차는 RAID 1 배열를 다시 빌드하는 오류 드라이브를 교체하기 위해 새 드라이브를 추가 했다고 가정합니다. (주의: 새 드라이브는 이전 드라이브보다 용량이 같거나 커야 합니다.)

컴퓨터를 끄고 고장난 하드 드라이브를 새 드라이브로 교체합니다. 시스템을 다시 시작하십시오. 운영 체제에 있는 동안 시작 메뉴에서 **Intel® Optane™ Memory and Storage Management** 유틸리티를 실행합니다.

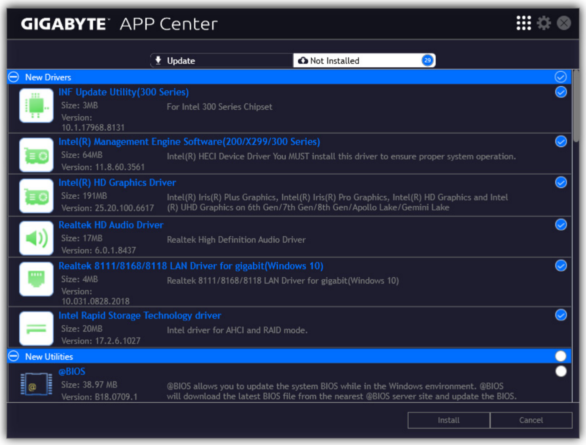
1. **Manage** 메뉴로 가서 **Manage Volume**에서 **Rebuild to another disk**를 클릭합니다.
2. RAID를 재구축할 새 드라이브를 선택하고 **Rebuild**를 클릭합니다.
3. 화면 오른쪽의 **Status** 항목에 재구축 진행 상황이 표시됩니다. RAID 1 볼륨의 재구축이 완료되면 **Status**가 **Normal**로 표시됩니다.

3-3 드라이버 설치

운영 체제를 설치하면 APP Center를 통해 드라이버 및 GIGABYTE 애플리케이션을 다운로드하고 설치할지 묻는 대화 상자가 데스크톱의 우측 하단에 나타납니다. **Install**을 클릭하여 설치를 진행합니다. (BIOS 설정에서, **Settings\IO Ports\APP Center Download & Install Configuration\APP Center Download & Install**이 **Enabled**로 설정되었는지 확인하십시오.)



최종 사용자 사용권 계약 대화 상자가 나타나면 <Accept>를 눌러서 APP Center를 설치합니다. APP Center 화면에서 설치려는 드라이버와 애플리케이션을 선택하고 **Install**을 클릭합니다.



설치하기 전에 시스템이 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

자세한 소프트웨어 정보는 GIGABYTE 웹사이트를 참조하십시오.

자세한 문제 해결 정보는 GIGABYTE 웹사이트를 참조하십시오.

3-4 디버그 LED 코드

일반 부팅

코드	설명
10	PEI 코어가 시작되었습니다.
11	사전 메모리 CPU 초기화가 시작되었습니다.
12~14	예약됨.
15	사전 메모리 North-Bridge 초기화가 시작되었습니다.
16~18	예약됨.
19	사전 메모리 South-Bridge 초기화가 시작되었습니다.
1A~2A	예약됨.
2B~2F	메모리 초기화.
31	메모리 설치됨.
32~36	CPU PEI 초기화.
37~3A	IOH PEI 초기화.
3B~3E	PCH PEI 초기화.
3F~4F	예약됨.
60	DXE 코어가 시작되었습니다.
61	NVRAM 초기화.
62	PCH 런타임 서비스 설치.
63~67	CPU DXE 초기화가 시작되었습니다.
68	PCI host bridge 초기화가 시작되었습니다.
69	IOH DXE 초기화.
6A	IOH SMM 초기화.
6B~6F	예약됨.
70	PCH DXE 초기화.
71	PCH SMM 초기화.
72	PCH 장치 초기화.
73~77	PCH DXE 초기화(PCH 모듈별).
78	ACPI 코어 초기화.
79	CSM 초기화가 시작되었습니다.
7A~7F	AMI용으로 예약됨.
80~8F	OEM용으로 예약됨(OEM DXE 초기화 코드).
90	DXE에서 BDS(부팅 장치 선택)로 위상 전송.
91	드라이버 연결을 위한 이벤트 발급.

코드	설명
92	PCI 버스 초기화가 시작되었습니다.
93	PCI 버스 핫플러그 초기화.
94	몇 개의 리소스를 감지할 것에 대한 PCI 버스 열거를 요청했습니다.
95	리소스를 요청한 PCI 장치를 확인하십시오.
96	PCI 장치 리소스를 할당하십시오.
97	콘솔 출력 장치 연결(예: 모니터에 불이 들어옴).
98	콘솔 입력 장치 연결(예: PS2/USB 키보드/마우스를 사용 중임).
99	수퍼 IO 초기화.
9A	USB 초기화가 시작되었습니다.
9B	USB 초기화 프로세스 중 재설정 발급.
9C	현재 연결된 모든 USB 장치를 검색하고 설치합니다.
9D	현재 연결된 모든 USB 장치를 활성화합니다.
9E~9F	예약됨.
A0	IDE 초기화가 시작되었습니다.
A1	IDE 초기화 프로세스 중 재설정 발급.
A2	현재 연결된 모든 IDE 장치를 검색하고 설치합니다.
A3	현재 연결된 모든 IDE 장치를 활성화합니다.
A4	SCSI 초기화가 시작되었습니다.
A5	SCSI 초기화 프로세스 중 재설정 발급.
A6	현재 연결된 모든 SCSI 장치를 검색하고 설치합니다
A7	현재 연결된 모든 SCSI 장치를 활성화합니다.
A8	필요 시 비밀번호를 확인합니다
A9	BIOS 설치가 시작되었습니다.
AA	예약됨.
AB	BIOS 설정 시 사용자 명령을 기다립니다.
AC	예약됨.
AD	OS 부팅에 대한 Ready To Boot(부팅 준비)를 발급합니다.
AE	레거시 OS로 부팅.
AF	부팅 서비스를 종료합니다.
B0	런타임 AP 설치를 시작합니다.
B1	런타임 AP 설치를 종료합니다.
B2	레거시 옵션 ROM 초기화.
B3	필요 시 시스템을 초기화합니다.

코드	설명
B4	USB 장치 핫 플러그인.
B5	PCI 장치 핫 플러그.
B6	NVRAM 정리.
B7	NVRAM 설정 재구성.
B8~BF	예약됨.
C0~CF	예약됨.

S3 Resume

코드	설명
E0	S3 Resume이 시작되었습니다(DXE IPL에서 요청함).
E1	S3 resume에 대한 부팅 스크립트 데이터를 채웁니다.
E2	S3 resume에 대한 VGA를 초기화합니다.
E3	OS S3 다시 시작 벡터 요청.

복구

코드	설명
F0	잘못된 펌웨어 볼륨 감지로 인해 복구 모드를 시작합니다.
F1	사용자 결정으로 복구모드를 시작합니다.
F2	복구를 시작합니다.
F3	복구 펌웨어 이미지를 찾았습니다.
F4	복구 펌웨어 이미지를 로드했습니다.
F5~F7	차후 AMI 프로세스 코드용으로 예약되었습니다.

오류

코드	설명
50~55	메모리 초기화 오류가 발생했습니다.
56	잘못된 CPU 유형 또는 속도입니다.
57	CPU가 일치하지 않습니다.
58	CPU 자가 진단 오류 또는 CPU 캐시 오류일 수 있습니다.
59	CPU 마이크로 코드를 찾을 수 없거나 마이크로 업데이트에 실패했습니다.
5A	내부 CPU 오류입니다.
5B	PPI 재설정에 실패했습니다.
5C~5F	예약됨.
D0	CPU 초기화 오류입니다.
D1	IOH 초기화 오류입니다.

코드	설명
D2	PCH 초기화 오류입니다.
D3	일부 아키텍처 프로토콜을 사용할 수 없습니다.
D4	PCI 리소스 할당 오류입니다. 리소스 범위 밖입니다.
D5	레거시 옵션 ROM 초기화를 위한 공간이 없습니다.
D6	콘솔 출력 장치를 찾을 수 없습니다.
D7	콘솔 입력 장치를 찾을 수 없습니다.
D8	암호가 틀립니다.
D9~DA	부팅 옵션을 로드할 수 없습니다.
DB	플래시 업데이트에 실패했습니다.
DC	프로토콜 재설정에 실패했습니다.
DE~DF	예약됨.
E8	S3 resume에 실패했습니다.
E9	S3 Resume PPI를 찾을 수 없습니다.
EA	S3 Resume 부팅 스크립트가 잘못되었습니다.
EB	S3 OS 다시 시작 요청에 실패했습니다.
EC~EF	예약됨.
F8	PPI복구를 사용할 수 없습니다.
<F9>	복구 캡슐을 찾을 수 없습니다.
FA	잘못된 복구 캡슐입니다.
FB~FF	예약됨.

Regulatory Notices

United States of America, Federal Communications Commission Statement

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: **Motherboard**
Trade Name: **GIGABYTE**
Model Number: **Z590 AORUS ULTRA**

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**
Address: 17358 Railroad street, City Of Industry, CA91748
Tel.: 1-626-854-9338
Internet contact information: https://www.gigabyte.com

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC with its action in ET Docket 96-8 has adopted a safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC certified equipment. The Intel PRO/Wireless 5000 LAN products meet the Human Exposure limits found in OET Bulletin 65, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper operation of this radio according to the instructions found in this manual will result in exposure substantially below the FCC's recommended limits.

The following safety precautions should be observed:

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, while transmitting.
- Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; if not, the radio may be damaged.
- Use in specific environments:
  - The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the constraints posed by the safety directors of such environments.
  - The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation Administration (FAA).
  - The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by each hospital.

Antenna use:
In order to comply with FCC RF exposure limits, low gain integrated antennas should be located at a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) or more from the body of all persons.

Explosive Device Proximity Warning
Warning: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the device has been modified to be qualified for such use.

Antenna Warning
The wireless adapter is not designed for use with high-gain antennas.

Use On Aircraft Caution
Caution: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical aircraft instruments.

Other Wireless Devices
Safety Notices for Other Devices in the Wireless Network: Refer to the documentation supplied with wireless Ethernet adapters or other devices in the wireless network.

Canada, Canada-Industry Notice:
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes:
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15-to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25-to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order tocomply with the E.I.R.P limit for the 5.25-to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dansla bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable.
dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be chosen so that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity
This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ErP Directive 2009/125/EC, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.
This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement
GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling

The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)
Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive équipements radioélectriques 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863.
La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Funkanlagen Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung.
Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zurEuropäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade
Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863.
A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

CE Declaración de conformidad
Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC 2014/30/EU, Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, Directiva de equipamentos de rádio 2014/53/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU y la Declaración 2015/863.
El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

CE Dichiarazione di conformità
I prodotti con il marchio CE sono conformi con una o più delle seguenti Direttive UE, come applicabile: Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva di apparecchiature radio 2014/53/UE, Direttiva RoHS 2011/65/EU e Dichiarazione 2015/863.
La conformità con tali direttive viene valutata utilizzando gli Standard europei armonizzati applicabili.

Deklaracja zgodności UE Unii Europejskiej
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywa urządzeń radiowych 2014/53/UE, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa2015/863.
Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dyrektywy.

ES Prohlášení o shodě
Toto zařízení splňuje požadavky Směrnice o Elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, Směrnice o Nízkém napětí 2014/35/EU, Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863.
Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic.

EK megfelelőségi nyilatkozata
A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek, azok a kiállításidőpontjában érvényes, aktuális változatában: EMC irányelv 2014/30/EU, Kisfeszültségű villamos berendezésekre vonatkozó irányelv 2014/35/EU, rádióberendezések irányelv 2014/53/EU, RoHS irányelv 2011/65/EU és 2015/863.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των παρακάτω Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Οοδηγία χαμηλή τάση 2014/35/EU, Οδηγία 2014/53/ΕΕ σε ραδιοεξοπλισμό, Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και 2015/863.
Η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες αξιολογείται χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

European Community Radio Equipment Directive Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.
This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States.
The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
SI	SK	TR	UK			

Wireless module manufacturer: Intel® Corporation SAS
Wireless module model name: AX200NGW

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明：

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

Korea KCC NCC Wireless Statement:

5,25GHz - 5,35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다。

Japan Wireless Statement:

5.15 GHz 帯 ~ 5.35 GHz 帯: 屋内のみの使用。

Wireless module country approvals:

Wireless module manufacturer: Intel® Corporation
Wireless module model name: AX200NGW

United States: FCC: PD9AX200NG	India: ETA-SD-20190501112	Serbia: И011 19	Taiwan: CCAH19LP1280T3
Canada: IC: 1000M-AX200NG	Japan: R 003-190022 T D190021003 5.15~5.35GHz 屋内限定 5.15~5.35GHz indoor use only		
Australia & New-Zealand:		Singapore: Complies with IMDA Standards DB02941	Ukraine: UA.TR.028
Belarus:	Mexico: AX200NGW RCPINAX19-0480	South Korea: R-C-INT-AX200NGW 1.상호명: Intel Corporation 2.기자재의 명칭(모델명): 특정소출력 무선기기 (무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX200NGW 3.제조시기: 2019/02 4.제조자/제조국: Intel Corporation / China	
China: CMIIT ID: 2019AJ2274(M)	Pakistan: Approved by TPA: 9.9211/2019		
Europe:	Qatar: CSA/SM/2019/R-7710		

연락처

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
주소: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan
전화: +886-2-8912-4000, 팩스: +886-2-8912-4005
기술 및 기타 지원(판매/마케팅): https://esupport.gigabyte.com
웹 주소(영어): https://www.gigabyte.com
웹 주소(중국어): https://www.gigabyte.com/tw

- **GIGABYTE eSupport**

  기술적인 내용을 포함한 각종질문(판매/마케팅)을 문의하려면, 다음 주소로 문의하십시오:
  https://esupport.gigabyte.com